

股票代號：3321

同泰電子科技股份有限公司
UNIFLEX TECHNOLOGY INC.

一一四年度年報

查詢年報網址：

金管會指定之資訊申報網站：<https://mops.twse.com.tw>

公司揭露年報相關資料：<https://www.uniflex.com.tw>

中 華 民 國 115 年 4 月 27 日 刊 印

一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發言人

姓 名：曾山一

職 稱：總經理

電 話：(03) 215-0198

電子郵件信箱：public@uniflex.com.tw

代理發言人

姓 名：蔡文程

職 稱：財會處長

電 話：(04) 2681-7070

電子郵件信箱：public@uniflex.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

單	位	地	址	電	話
<u>桃園總部</u>		臺灣桃園市桃園區興邦路38號		(03) 215-0198	
<u>台灣同泰</u>					
台中東二廠		臺灣台中市大甲區東二街28號		(04) 2681-7090	
台中青年廠		臺灣台中市大甲區青年路123號		(04) 2681-7070	
台中幼七廠		臺灣台中市大甲區工二路33號		(04) 2681-0070	
<u>中國同揚</u>					
中國同揚廠		中國江蘇省揚州經濟開發區華揚西路77號		+86-514-8796-0000	

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名 稱：宏遠證券股份有限公司

地 址：台北市大安區信義路四段236號3樓

網 址：www.honsec.com.tw

電 話：(02)2326-8818

四、最近年度財務報告簽證會計師、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：陳憲正、林冠宏

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地 址：台北市基隆路一段333號27樓

網 址：www.pwc.tw

電 話：(02) 2729-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、本公司網址：<https://www.uniflex.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告	
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	3
二、公司治理運作情形.....	15
三、會計師公費資訊.....	35
四、更換會計師資訊.....	35
五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間.....	35
六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	35
七、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	36
八、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	36
參、募資情形	
一、資本及股份.....	37
二、公司債(含海外公司債)辦理情形.....	38
三、特別股辦理情形.....	38
四、海外存託憑證辦理情形.....	38
五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形.....	38
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	38
七、資金運用計劃執行情形.....	38
肆、營運概況	
一、業務內容.....	39
二、市場及產銷概況.....	49
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率.....	54
四、環保支出資訊.....	54
五、勞資關係.....	54
六、資通安全管理.....	55
七、重要契約.....	56
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	
一、財務狀況.....	57
二、財務績效.....	58
三、現金流量.....	58
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	59
五、最近年度轉投資政策，其獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫.....	59
六、風險事項之分析評估.....	59
七、其他重要事項.....	61

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料.....	62
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	62
三、其他必要補充說明事項.....	62
四、最近年度及截至年報刊印日止，證交法第三十六條第二項第二款所定對股東 權益或證券價格有重大影響之事項.....	62

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生們：

感謝各位股東在百忙之中撥冗參加，同泰電子科技股份有限公司115年股東常會。茲將本公司114年度經營成果及未來營運計畫概要報告如下：

一、114年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

本公司114年度銷貨收入淨額為新台幣2,145,029仟元，較去年同期之銷貨收入淨額1,966,140仟元，增加178,889仟元；銷貨毛利為130,932仟元，較去年同期之銷貨毛利44,909仟元，毛利增加86,023仟元；稅後淨損為180,132仟元，較去年同期之稅後淨損208,482仟元，減少28,350仟元；114年度每股稅後淨損為3.36元。

(二)預算執行情形

本公司未發佈財務預測數，故不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析

分析項目		113 年度	114 年度
財務收支	財務收入(仟元)	1,966,140	2,145,029
	財務支出(仟元)	2,200,096	2,290,878
獲利能力	資產報酬率(%)	(10.22)	(7.90)
	股東權益報酬率(%)	(37.30)	(30.43)
	營業利益佔實收資本額比率(%)	(24.08)	(16.94)
	稅前純益佔實收資本額比率(%)	(20.87)	(20.00)
	純益率(%)	(10.60)	(8.40)
	每股盈餘(元)	(3.93)	(3.36)

(四)研究發展狀況

本公司一直致力於加強高附加價值產品之研發與製造技術能力，持續了解客戶未來需求及市場運用走向，研發持續提升新產品開發，新材料、新製程及設備評估，以最有競爭力的生產成本製作符合客戶規格之產品，滿足顧客需求，為公司創造更佳的獲利。

本公司研發團隊積極與產、官、學合作，企業競爭力維繫於不斷創新與研發；本公司未來將持續進行前瞻性技術與創新應用的研發並落實產品化設計、量產化研究與系統化管理，期能提升產品品質，同時有效降低生產成本，以不負客戶的要求與期望。掌握新趨勢及技術發展趨勢，研究各製程及新產品解決方案，以提供客戶技術諮詢與發展。

二、114 年度營業計畫概要

(一)經營方針

- 1.精：專精於滿足客戶需求、加速流程、杜絕浪費、提升品質、持續改善。
- 2.悍：目標明確，使命必達。
- 3.迅捷：充分授權、當機立斷、快速有效、不斷求新及求進步。

(二)重要之產銷政策

維持現有eReader、eNote、ESL、PAD、NB、車載CID(Center Information Display)及車燈等產品類型，持續佈局智慧眼鏡、機器人靈巧手、AI液冷模組及CPO(Co-Packaged Optics)，同時進行國內外品牌客戶開發深耕與既有客戶服務最佳化，建立多元化的行銷通路，分散市場風險及提高公司獲利能力。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

未來公司以持續提昇開發新產品及研發技術能力，為客戶提供最好的品質。面對外部競爭環境、法規環境及總體經營環境變遷快速，本公司以合理化工作改善及激勵員工士氣，提升產品品質，獲得客戶信賴並以強化財務結構，落實穩健經營，培養專業經理人，完善公司治理，做最佳的應變能力並提升國際化競爭力，同時本人及公司全體員工必盡最大努力為公司有效降低成本及創造更佳獲利，以不負所有股東的期望與支持。

敬祝 全體股東

身體健康 萬事如意

董事長 簡山傑

貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

1. 董事資料

單位：股 115 年 4 月 27 日

職 稱	國 籍 或 註 冊 地	姓 名	性 別/ 年 齡	選 (就) 任 日 期	任 期	初次選 任日期	選 任 時 持 有 股 份		現 在 持 有 股 數		配 偶、未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管、董 事 或 監 察 人			備 註
							股 數	持 股 比 率 %	股 數	持 股 比 率 %	股 數	持 股 比 率 %	股 數	持 股 比 率 %			職 稱	姓 名	關 係	
董事	中 華 民 國	欣揚投資 (股)公司	-	113. 6.27	3 年	99.6.30	10,885,165	11.20	5,950,528	6.91	-	-	-	-	不適用	不適用	無	無	無	-
董事 長	中 華 民 國	欣揚投資 (股)公司 代表人： 簡山傑	男 61-70	115. 3.19	1 年	115.3.19	-	-	-	-	-	-	-	-	台大化工系 - 聯華電子股份有限公司總經理	註 1	無	無	無	-
副董 事長	中 華 民 國	欣揚投資 (股)公司 代表人： 郭政輝	男 71-80	113. 6.27	3 年	110.8.20	-	-	-	-	-	-	-	-	淡江大學化工系 華通電腦股份有限公司副總經理 - 欣興電子股份有限公司品質長	註 2	無	無	無	-
董事	中 華 民 國	欣揚投資 (股)公司 代表人： 鍾明峰	男 51-60	113. 6.27	3 年	113.6.27	-	-	-	-	-	-	-	-	陽明交通大學管理學院碩士 - 旭德科技(股)公司資深副總經理	註 3	無	無	無	-
董事	中 華 民 國	曾山一	男 51-60	113. 6.27	3 年	110.8.20	774,178	0.80	979,086	1.14	-	-	-	-	淡江大學企管系	同泰電子科技股份有限公司總經理 同揚光電(江蘇)有限公司法定代表人暨總經理 Uniflex Group Limited 董事	無	無	無	-

職 稱	國 籍 或 註 冊 地	姓 名	性 別/ 年 齡	選 (就) 任 日 期	任 期	初 次 選 任 日 期	選 任 時 持 有 股 份		現 在 持 有 股 數		配 偶、未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管、董 事 或 監 察 人			備 註
							股 數	持 股 比 率 %	股 數	持 股 比 率 %	股 數	持 股 比 率 %	股 數	持 股 比 率 %			職 稱	姓 名	關 係	
獨立 董事	中 華 民 國	李 松 山	男 51-60	113. 6.27	3 年	104.5.29	-	-	-	-	-	-	-	-	國 立 中 正 大 學 財 務 金 融 研 究 所 京 元 電 子 股 份 有 限 公 司 公 司 財 務 協 理 閔 康 科 技 (股) 公 司 副 總 經 理	地 心 引 力 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 閔 康 科 技 (股) 公 司 顧 問	無	無	無	-
獨立 董事	中 華 民 國	曾 雯 如	女 61-70	113. 6.27	3 年	113.6.27	-	-	-	-	-	-	-	-	陽 明 交 通 大 學 管 理 學 院 碩 士 智 原 科 技 股 份 有 限 公 司 公 司 副 總 經 理	註 4	無	無	無	-
獨立 董事	中 華 民 國	張 淑 如	女 51-60	113. 6.27	3 年	113.6.27	-	-	-	-	-	-	-	-	中 華 大 學 工 業 管 理 學 系 兆 遠 科 技 股 份 有 限 公 司 公 司 行 政 財 務 協 理	無	無	無	無	-

註 1：欣興電子股份有限公司董事長暨集團策略長、HEMINGWAY INT'L LIMITED 董事長、UMTC HOLDINGS LIMITED 董事長、UniBest Holding Limited 董事長、UniWonderful Holding Limited 董事長、UNIMICRON HOLDING LIMITED 董事長

註 2：欣興電子股份有限公司顧問、昆山欣富興企業管理有限公司董事、昆山鼎昌鑫電子科技有限公司董事、昆山鼎盛鑫電子有限公司董事、欣興同泰科技(昆山)有限公司法定代表人、黃石欣立企業管理有限公司董事、群景投資有限公司董事、BEST OPTION INVESTMENTS LIMITED 董事、NEOCONIX, INC.董事、Unimicron Germany GmbH 監察人

註 3：欣興電子股份有限公司副總經理、Advanced Numicro System Inc.董事、Maruwa Corporation 監察人、SMART IDEA HOLDINGS LIMITED 董事、Unimicron JAPAN Co.,Ltd.監察人、同揚光電（江蘇）有限公司董事、旭興電子股份有限公司監察人、亞太優勢微系統股份有限公司董事、昆山鼎盛鑫電子有限公司董事、欣揚投資股份有限公司監察人、欣鮮園股份有限公司董事長、焱元投資股份有限公司董事、黃石晶緯達光電科技有限公司董事、諧永投資股份有限公司監察人、蘇州群峰企業管理有限公司總經理

註 4：智原科技(股) 公司董事暨副總經理、Faraday Technology (Mauritius) Corp. 董事長、Faraday Technology (Samoa) Corp. 董事長、Bright Capital Group Limited (BCGL) 董事長、Faraday Technology Corp.(B.V.I.) 董事長、Artery Technology Corporation 董事、Sinble Technology Pte. Ltd. 董事、諧永投資(股) 公司董事、雅特力科技(股) 公司董事、雅特力科技(重慶) 有限公司董事、智原科技(上海) 有限公司監察人、智原微電子(蘇州) 有限公司監察人、原璟科技(重慶) 有限公司監察人、重慶寅通科技有限公司監察人、上海環創電子科技有限公司監察人、昇邁科技(股) 公司監察人、Faraday Technology Japan Corp. 監察人

2. 法人股東之主要股東

115 年 4 月 27 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
欣揚投資股份有限公司 持股基準日：114.6.23	欣興電子(股)公司 100.00%

3. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東：

115 年 4 月 27 日

法人名稱	法人之主要股東
欣興電子股份有限公司 持股基準日：114.7.14	聯華電子股份有限公司 13% 富邦人壽保險股份有限公司 3.3% 國泰人壽保險股份有限公司 2.31% 花旗託管新加坡政府投資專戶 1.99% 新制勞工退休基金 1.69% 中華郵政股份有限公司 1.58% 焱元投資股份有限公司 1.5% 南山人壽保險股份有限公司 1.31% 渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司 之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 1.23% 摩根託管梵加德新興市場股票指數 1.1%

4.董事資料

(1)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
欣揚投資(股) 公司 代表人：簡山傑		1.畢業於台灣大學化工系，現任本公司董事長、兼任欣興電子董事長及其他多家公司法人代表，已具有超過五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 2.未有公司法第 30 條各款情事。	(不適用)	0
欣揚投資(股) 公司 代表人：郭政輝		1.畢業於淡江大學化工系，現任本公司董事、兼任欣興電子顧問及其他多家公司法人代表，已具有超過五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 2.未有公司法第 30 條各款情事。	(不適用)	0
欣揚投資(股) 公司 代表人：鍾明峰		1.畢業於陽明交通大學管理學院碩士，現任本公司董事、兼任欣興電子副總經理及其他多家公司董事，已具有超過五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 2.未有公司法第 30 條各款情事。	(不適用)	0
曾山一		1.畢業於淡江大學企管系，現任本公司董事、兼任本公司總經理及大陸子公司法人代表及總經理等，已具有超過五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 2.未有公司法第 30 條各款情事。	(不適用)	0
李松山		1.畢業於中正大學財務金融研究所，現任本公司獨立董事及審計委員、兼任閎康科技股份有限公司顧問，已具有超過五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 2.未有公司法第 30 條各款情事。	1.本公司獨立董事，符合獨立性情形。 2.獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 3.最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	1

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
曾雯如		1.畢業於陽明交通大學管理學院碩士，現任本公司獨立董事及審計委員、兼任智原科技副總經理及其他多家公司法人代表等，已具有超過五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 2.未有公司法第 30 條各款情事。	1.本公司獨立董事，符合獨立性情形。 2.獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 3.最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	0
張淑如		1.畢業於中華大學工業管理學系，現任本公司獨立董事及審計委員、曾任兆遠科技(股)公司行政財務協理等，已具有超過五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 2.未有公司法第 30 條各款情事。	1.本公司獨立董事，符合獨立性情形。 2.獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 3.最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	0

(2)董事會多元化及獨立性：

A.董事會多元化：

本公司現任董事會由 7 位董事組成，並設置 3 席獨立董事(占比為 42.86%)，2 席女性董事(占比為 28.57%)，女性董事席次目前雖未達 1/3，但本公司已於 113 年度董事改選時，多增加一席女性董事，本公司並將持續增加合適的女性董事，改善公司董事性別多元化情形。

每位董事均在各領域有不同專長，例如：經營管理、財務會計、相關產業知識及領導決策等。考量目前全球對環境、公司治理等相關議題越發看重，以及為促進董事會組成與結構之健全發展，目前董事成員多元化將視公司發展需要其他專業能力之成員，使董事會功能更趨完善，提昇公司永續競爭力。

本屆董事會成員多元化之情形依「上市上櫃公司治理實務守則」第 20 條明載董事會整體應具備之能力如下表：

董事姓名	國籍	性別	具有員工身分	董事會整體應具備之能力							
				營運判斷	會計財務	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
欣揚投資(股)公司 代表人：簡山傑	中華民國	男		V	V	V	V	V	V	V	V
欣揚投資(股)公司 代表人：鍾明峰		男		V	V	V	V	V	V	V	V
欣揚投資(股)公司 代表人：郭政輝		男		V		V	V	V	V	V	V

曾山一		男	V	V	V	V	V	V	V	V	V
李松山		男		V	V	V	V	V	V	V	V
曾雯如		女		V	V	V	V	V	V	V	V
張淑如		女		V	V	V	V	V	V	V	V

B.董事會獨立性：

- a.本公司現任董事會含 3 位獨立董事，占比 43%，董事會具行使職權之獨立。
- b.本公司全體董事並無下列證交法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定之親屬關係，且本公司已於 104 年起廢除監察人，改為選任獨立董事，並組成審計委員會獨立行使職權。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115 年 4 月 27 日

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任 日期	持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人名義持有 股份		主要(學)經歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等 以內 關係之經理人			備 註
					股數	持股 比率%	股數	持股 比率%	股數	持股比率%			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	曾山一	男	99.4.1	979,086	1.14	-	-	-	-	淡江大學企管系 同泰電子科技(股)公司總經理	同揚光電(江蘇)有限公司 法定代表人暨總經理 Uniflex Group Limited 董事	無	無	無	-
資深 副總經理	中華民國	李光偉	男	108.9.1	748,096	0.87	-	-	-	-	元智大學製造工程與管理技術系 欣興同泰科技(昆山)有限公司副總經理	同揚光電(江蘇)有限公司 資深副總經理	無	無	無	-
財會 處長	中華民國	蔡文程	男	99.11.30	160,574	0.19	-	-	-	-	元智大學會計系 安侯建業聯合會計師事務所副理	同揚光電(江蘇)有限公司 監察人	無	無	無	-
協理	中國	田鷹	男	114.10.21	-	-	-	-	-	-	中國河海大學工商管理系 同揚光電(江蘇)有限公司品經處處長	同揚光電(江蘇)有限公司品 經處協理	無	無	無	-
協理	中國	趙永興	男	114.10.21	-	-	-	-	-	-	中國南京財經大學市場行銷專業系 同揚光電(江蘇)有限公司業務處處長	同揚光電(江蘇)有限公司業 務處協理	無	無	無	-

(三) 最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

1. 董事之酬金

單位：新台幣仟元

職 稱	姓 名	董事酬金								A、B、 C 及 D 等四項總額 占稅後純益之 比例	兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、 E、F 及 G 等七 項總額占稅後純 益之比例	領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 或母 公司 酬金		
		報酬(A)		退職退 休金(B)		董事酬勞 (C)		業務執行費 用(D)			薪資、獎金及特 支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)							
		本公司	財務 報告 內所有 公司	本公司	財務 報告 內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司		本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務 報告 內所有 公司	本公司		財務報告內 所有公司				本公司	財務報 告內所有 公司
董事長	欣揚投資(股)公司 代表人：曾子章(註 1)	-	-	-	-	-	-	30	30	-0.02	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.01	無
董事長	欣揚投資(股)公司 代表人：簡山傑(註 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無
董事	欣揚投資(股)公司 代表人：鍾明峰	-	-	-	-	-	-	25	25	-0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.01	無
董事	欣揚投資(股)公司 代表人：郭政輝	-	-	-	-	-	-	30	30	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.02	無
董事	曾山一	-	-	-	-	-	-	30	30	-0.02	-0.02	2,961	4,161	108	108	-	-	-	-	-1.72	-2.39	無
獨立 董事	李松山	600	600	-	-	-	-	25	25	-0.35	-0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.35	-0.35	無
獨立 董事	曾雯如	600	600	-	-	-	-	30	30	-0.35	-0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.35	-0.35	無
獨立 董事	張淑如	600	600	-	-	-	-	30	30	-0.35	-0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.35	-0.35	無
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：依據本公司「董監酬勞分配及報酬管理辦法」規定獨立董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給每月報酬，惟獨立董事不參與年度盈餘分配所提撥之董監酬勞。																						
2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																						

註 1：於 115 年 3 月解任。

註 2：於 115 年 3 月新任。

2.總經理及副總經理

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註 1)		退職退休金 (B)(註 2)		獎金及 特支費等等(C) (註 3)		員工酬勞金額(D)				A、B、 C 及 D 等 四項總額占稅後純 益之比例(%)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金
		本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報告 內所有公 司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告 內所有公 司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	曾山一	4,560	6,312	216	216	958	967	-	-	-	-	-3.18	-4.16	-
資深副總經理	李光偉													

註1：係指114年度支付總經理、副總經理之報酬。

註2：係指114年度提撥至政府機關之金額。

註3：係指114年度總經理、副總經理獎金及特支費等。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元		
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）		
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	曾山一、李光偉	李光偉
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）		曾山一
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）		
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）		
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）		
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）		
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）		
100,000,000 元以上		
總 計	2 人	2 人

上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及 D等四項總額 占稅後純益之 比例(%)		領取來自子公司以外 轉投資事業或 母公司酬金
												本公司	財務報告內所有公司	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司			
現金金額	股票金額					現金金額	股票金額							
總經理	曾山一	2,520	3,720	108	108	441	441	-	-	-	-	-1.70	-2.37	-
資深副總經理	李光偉	2,040	2,592	108	108	517	526	-	-	-	-	-1.48	-1.79	-
財會處長	蔡文程	1,547	1,547	95	95	272	272	-	-	-	-	-1.06	-1.06	-
協理	田鷹	-	1,099	-	194	-	153	-	-	-	-	-	0.80	-
協理	趙永興	-	1,064	-	189	-	146	-	-	-	-	-	-0.78	-

3.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 12 月 31 日單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額佔稅後 純益之比例 (%)
經理人	總經理	曾山一	-	-	-	-
	資深副總經理	李光偉				
	財會處長	蔡文程				
	協理	田鷹				
	協理	趙永興				

(四)本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

1.本公司於最近兩年支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額佔個體財務報告稅後純益比例之分析

項目 \ 年度	113 年度酬金總額占 稅後純益比率(%)		114 年度酬金總額占 稅後純益比率(%)	
	本公司	合併報告內所有公司	本公司	合併報告內所有公司
董事	(2.40)	(2.99)	(2.81)	(3.48)
總經理及副總經理	(3.60)	(4.49)	(3.18)	(4.16)

2.給付上述人員酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、經營績效及未來風險之關聯性

本公司依據「董監酬勞分配及報酬管理辦法」發放獨立董事報酬及依據公司章程規定，分配董事報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之；另 114 年度因公司產生稅後虧損 180,132 仟元，故經董事會決議無分配董事酬勞。總經理及副總經理酬金包括薪資及獎金等，係依據該職等所賦予之職責，及該職位對公司營運之貢獻度及承擔之營運風險給予酬金。

二、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

1.114 年度董事會開會 6 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席 次數 B	委託出席 次數	實際出席(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事長	欣揚投資(股) 公司代表人： 曾子章	6	0	100	115.3.19 解任
副董事長	欣揚投資(股) 公司代表人： 郭政輝	6	0	100	
董事	欣揚投資(股) 公司代表人： 鍾明峰	5	1	83	
董事	曾山一	6	0	100	
獨立董事	李松山	5	1	83	
獨立董事	曾雯如	6	0	100	
獨立董事	張淑如	6	0	100	

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一) 證券交易法第14 條之3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第14 條之3 規定，相關資料請參閱年報第15頁審計委員會運作情形。

(二) 除前開事項之外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

1.董事會日期：114.4.21

董事姓名：曾山一董事。

議案內容：通過評估經理人年終獎金案。

應利益迴避原因：曾山一董事兼任同泰總經理。

表決情形：除曾山一董事迴避討論表決外，其餘出席董事無異議照案通過。

2.董事會日期：114.10.27

董事姓名：曾山一董事。

議案內容：通過評估經理人酬勞案案。

應利益迴避原因：曾山一董事兼任同泰總經理。

表決情形：除曾山一董事迴避討論表決外，其餘出席董事無異議照案通過。

3.董事會日期：114.11.28

董事姓名：曾山一董事。

議案內容：通過本公司 114 年現金增資員工認股辦法案。

應利益迴避原因：曾山一董事兼任同泰總經理。

表決情形：除曾山一董事迴避討論表決外，其餘出席董事無異議照案通過。

4.董事會日期：114.12.16

董事姓名：曾子章董事長、鍾明峰董事及郭政輝董事。

議案內容：通過本公司出租幼七廠部分土地及廠房給關係人欣興電子股份有限公司案。

應利益迴避原因：由於欣興、欣揚兩公司間具有控制從屬關係，即視為欣揚有自身利害關係，因此三位代表欣揚之董事(曾子章董事長、鍾明峰董事及郭政輝董事)進行利益迴避。

表決情形：除曾子章董事長、鍾明峰董事及郭政輝董事迴避外，其餘出席董事均無異議照案通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	114.1.1~114.12.31	董事會	董事會自評	對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
		審計委員會	董事會自評	對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
		薪酬報酬委員會	董事會自評	對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修等。
		個別董事成員	董事自評	對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任等。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

(一)董事教育訓練：統計114年董事教育訓練總時數為48小時。

(二)本公司設董事7席(含3為獨立董事)，並由全體獨立董事組成審計委員會及薪資報酬委員會，對董事會議案進行審議，藉以發揮監督職責，以強化公司治理，提升董事會運作職能；本公司114年審計委員會運作情形請參閱本年報第15頁「審計委員會運作情形」及薪資報酬委員會執行情形請參閱本年報第22頁「本公司薪資報酬委員運作情形」。

2. 114 年度董事進修情形

職稱	董事	日期	單位	課程名稱	時數
董事長	曾子章	114.7.9	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
副董事長	郭政輝	114.7.9	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
董事	鍾明峰	114.7.9	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
董事	曾山一	114.7.29 - 114.7.30	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管研習班	12
獨立董事	李松山	114.12.23	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監自保必知：洞悉犯罪者如何利用非常規交易、關係人交易之手法	3
		114.11.4	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	談綠色及轉型金融行動方案-永續發展藍圖與董事責任	3
獨立董事	曾雯如	114.11.27	社團法人中華獨立董事協會	碳定價機制及最新 IFRS 國際永續準則(S1&S2)的介紹	3
		114.9.23	社團法人中華獨立董事協會	美國關稅政策對我國經濟與企業的衝擊及因應措施	3
		114.5.26	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
獨立董事	張淑如	114.9.26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會	3

(二)審計委員會運作情形：

1.最近年度審計委員會開會 5(A)次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	李松山	4	1	80	
獨立董事	曾雯如	5	0	100	
獨立董事	張淑如	5	0	100	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

日期	期別	議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計 委員會意見 之處理
114.2.24	第一次	1.通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司 113 年度虧損撥補表案。 3.通過辦理減資彌補累積虧損案。 4.通過辦理現金增資發行新股案。 5.通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書案。 6.通過本公司 114 年度營運計畫及預算案。 7.通過本公司 114 年度資本支出計畫案。	同意	照案通過
114.4.21	第二次	1.通過本公司財務報表簽證會計師變更及委任案。 2.通過本公司 114 年第一季財務報表案。 3.通過辦理減資彌補累積虧損案。	同意	照案通過
114.7.28	第三次	1.通過本公司 114 年第二季合併財務報告案。 2.通過本公司與第一銀行續簽遠期外匯合約案	同意	照案通過
114.10.27	第四次	1.通過修訂本公司及子公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 2.通過 114 年度委任會計師簽證財務報表公費案。 3.通過通過子公司 Uniflex Investment Limited 資金貸與本公司資金貸與案。	同意	照案通過
114.12.16	第五次	1.通過本公司出租幼七廠部分土地及廠房給關係人欣興電子股份有限公司案。	同意	照案通過

(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等：本公司獨立董事不定期與內部稽核主管及會計師諮詢、洽談，溝通管道順暢。

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		
	是	否	摘要說明
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司訂有「公司治理守則」，針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升透明度等皆有相關規範；有關本公司公司治理守則可至本公司網站查詢。
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(一)本公司設有股務單位及發言人處理股東建議、紛等問題，若糾紛涉及法律問題，則由法律處理。 (二)本公司由股務專人及股務代理機構負責。 (三)本公司於內部控制制度電腦化資訊系統處及內部重大資訊處理作業程序訂定防火牆落實執行。 (四)本公司於內部控制制度訂定防範內線交易法禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣證券。
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		(一)本公司在設定董事會成員組合時，會從多個角度考慮董事會成員多元化，所有委任均以用人唯才為原則。 (二)本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，尚無設置提名或其他各類功能性委員會，但針對各項業務功能別，依公司之作業處理辦法管機制，並由各單位主管依權責負責各項職管。 (三)本公司將依已訂定董事會績效評估辦法及方式，每年定期進行績效評估。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？			(四)本公司董事會每年定期評估簽證會計師之獨立性，114年經審閱簽證會計師出具之獨立聲明書，並評估簽證會計師與本公司除簽證及相關稅務等案件之費用外，並無其他財務利益或業務往來關係，簽證會計師非為本公司股東及未兼任本公司及關係企業任何職位。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司已設置公司治理主管，故相關業務已由該位主管負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)。	無重大差異。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司與往來銀行、債權人、員工、客戶、供應商均有暢通之溝通管道，另本公司網站設有投資人專區，並有發言人及代理發言人擔任公司對外之溝通管道，可妥適回應相關議題。	無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司已委託專業股務代辦機構宏遠證券，處理各項股務相關事宜。	無重大差異。
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		(一)本公司依據法令將相關財務業務及重大訊息資訊公開於公開資訊觀測站，並將於公司網站設立公司治理專區揭露相關訊息。 (二)有專人負責相關資訊之蒐集，及公司重大事項之揭露，並已按法令規範選派適任人員擔任發言人及代理發言人。 (三)本公司依照證券交易法第36條規定之期限內公告並申報年度財務報告(三個月內)，第一、二、三季財務報告(45天內)與各月份營運情形(每月10日前)。	無重大差異。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關	V		(一)員工權益：本公司依勞基法規定保障員工權益。 (二)僱員關懷：本公司提供相關福利制度及良好的教	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？			育訓練，與員工建立互相信賴之關係。 (三)投資者關係：設有專人服務及股務單位專責處理股東建議。 (四)供應商關係：本公司定期進行供應商評比，雙方充分溝通與供應商之間一向維繫良好的關係。 (五)利害關係人之權利：利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。 (六)本公司不定期提供董事需注意之相關法規資訊及相關單位舉辦之專業知識進修課程資訊，董事進修之情形：詳請第16頁「114年度董事進修情形」。 (七)本公司一向以穩健的原則進行相關之風險管理，訂有嚴密的內部控制制度以防範各項風險，並由內部稽核單位定期及不定期的查核內部控制制度的落實程度外，亦投保財產保險。 (八)客戶政策之執行情形：本公司及集團對所有客戶均有專責的業務及客服部負責服務，以確保及時回覆戶之需求，與客戶維持穩定良好關係，以創造公司利潤。 (九)本公司已於114年3月為董監事續投責任險。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：無。				

(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
李松山	1.畢業於中正大學財務金融研究所，現任本公司獨立董事及審計委員、兼任閎康科技股份有限公司顧問等，已具有超過五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 2.未有公司法第 30 條各款情事。	1.本公司獨立董事，符合獨立性情形。 2.獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 3.最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	1
曾雯如	1.畢業於陽明交通大學管理學院碩士，現任本公司獨立董事及審計委員、兼任智原科技副總經理及其他多家公司法人代表等，已具有超過五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 2.未有公司法第 30 條各款情事。	1.本公司獨立董事，符合獨立性情形。 2.獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 3.最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	0
張淑如	1.畢業於中華大學工業管理學系，現任本公司獨立董事及審計委員、曾任兆遠科技(股)公司行政財務協理等，已具有超過五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 2.未有公司法第 30 條各款情事。	1.本公司獨立董事，符合獨立性情形。 2.獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 3.最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	0

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：113年6月27日至116年6月26日，最近年度薪資報酬委員會開4次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A) (註)	備註
召集人	李松山	4	0	100	
委員	曾雯如	4	0	100	
委員	張淑如	4	0	100	
其他應記載事項： 一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。 二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。					

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司於113年設置永續推動小組，由總經理擔任永續發展策略最高決策主管，負責年度永續報告書重大主題及永續策略決核。	同摘要說明。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？		V	本公司尚未依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略。	同摘要說明。
三、環境議題 (一) 公司是否依其特性建立合適之環境管理制度？	V		本公司已導入環境管理制度 ISO14001 標準，經由系統化的管理手法，制定環境保護、職業安全衛生自主管理系統作業程序，將不定期針對廢棄物管理、節能與能源管理、資源回收與再利用、環境稽核與教育訓練、污染防治、法律遵循措施，進行稽核及持續維護制度有效性，達成永續發展目標。	無重大差異。
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		1.提升或汰換舊有設備提升產能效率，降低能源用量。 2.全公司在增設或更換照明設備時，選用節能燈管(LED 燈)。 3.設備汰換更新，優先選用高效能設備。 4.馬達設備全面汰換或新增變頻設備，降低能源耗用，達到溫室氣體減量目的。 5.執行垃圾分類並設置資源回收，並力求表單文件電子化，以降低對環境所造成之衝擊。	無重大差異。
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		1.著手提出面對氣候變遷議題之影響的氣候相關財務揭露。 2.在重大投資決策時，公司已經將氣候變遷議題納入考量。 3.充分了解與討論，例如:碳管理議題，能、資源使用如何因應氣候變遷風險等議題。	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		本公司每月檢討用水、用電、廢棄物產出量及原料耗損情形，以期降低能源不必要之浪費，並達到節能減碳及溫室氣體減量之目的，雖未制定溫室氣體減量目標，對減少用水及事業廢棄物管理減量 仍列為公司重要管理指標之一。	無重大差異。
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		本公司遵循各項勞動法令之規定並致力於職工福利的提升，在人性化、合理化的管理下，員工意見皆能得到充分的重視與改善。	無重大差異。
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		本公司員工薪資報酬係依「績效考核管理辦法」、「員工激勵獎金辦法」等人事管理規章辦理，已訂定合理薪資報酬政策，並設立明確有效之獎勵與懲戒制度。員工如有相關行為違反規範時，則視情節輕重提報懲處，並與績效考核制度做連結。	無重大差異。
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		本公司訂有「安全衛生工作守則」，規範員工工作環境之安全衛生及其教育訓練；另公司每年定期舉辦員工健康檢查作業，使員工清楚掌握自己的健康狀況。	無重大差異。
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		本公司每年皆會依據員工現況工作需求及職涯能力發展需要，提供合適訓練課程與預算。	無重大差異。
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？		V	本公司非最終產品製造者，此評估項目不適用。	同摘要說明。
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵	V		本公司訂有「供應商管理作業程序」及「供應商評鑑考核輔導作業」，以供應商之供應產品的能力為基	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
循相關規範，及其實施情形？			礎，建立選擇、評估及評鑑的機制，除要求供應商密切配合外，並採分級管理進行評鑑。進行供應商評鑑，除評估供應商之技術、品質及製造能力外，並評估其經營管理能力及環安，在敦促供應商達到品質穩定、交期準時、增加合作競爭優勢外，同時要求供應商落實員工照顧、環境保護、與職場安全衛生等管理作為，以善盡企業社會責任。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		V	1.本公司編製永續報告書，並依循全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative, GRI）所發布之 GRI 準則 GRI Standards (2021) 版本及「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」並參考氣候相關財務揭露建議書（Task Force on Climate related Financial Disclosures, TCFD）架構進行編製。 2.前揭報告書本公司尚未取得第三方驗證單位之確信或保證意見。	同摘要說明。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司尚未訂有「上市上櫃公司永續發展實務守則」。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (一)認養工業區樹木一起保護地球元氣。 (二)撇除歧視，積極錄用身心障礙員工，創造幸福之工作環境。 (三)長期捐贈支持慶祥青少年關懷協會。 (四)贊助參與 e 啟讀出未來-電子書閱讀器行動圖書館專案。				

八、氣候相關資訊執行情形：

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	為強化本公司對氣候相關風險機會議題之管理與鑑別，本公司於 113 年成立永續推動小組並同時負責氣候相關治理，由總經理擔任召集人，協助董事會訂定各項氣候風險管理政策、目標之落實、蒐整公司之氣候議題現況、推動氣候變遷策略發展，評估、追蹤環境管理數據，以及各項方案執行成效。並且為降低公司受氣候變遷之影響與財務衝擊、探尋公司於氣候變遷下之關鍵風險與機會議題及積極應對與掌握當前趨勢以提升公司之氣候韌性，小組每年針對公司之氣候關鍵機會風險議題進行會議，管理公司內各營運據點及廠區之氣候因應目標與追蹤行動達成情況，協助溝通、整合公司之氣候治理現況。

2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。					
	面向	議題	影響期程	氣候風險機會現況	因應策略與管理措施
	轉型風險	強化排放量報導義務	短期 (0-3 年內)	為配合法令進行申報或揭露訊息，強化碳訊息揭露，若揭露不實或有重大遺漏，可能面臨主管機關裁罰，造成公司負面影響、影響投資人權益並使公司面臨罰款，提高公司之營運成本。	1. 執行相關法規申報、調整、盤查與查證作業。 2. 法規落實度 100%。
		原物料成本上漲	短期 (0-3 年內)	氣候變遷影響物流運輸等原物料上游供應，進而造成原物料上漲或可能出現短缺，使得公司營運成本上升。	1. 重視在地採購、找尋綠色供應鏈、要求年度交易金額前五大之供應商進行減碳措施。 2. 執行供應商環境風險評估，設定供應鏈減碳目標。
	實體風險	颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高	長期 (10 年以上)	極端氣候導致颶風或驟雨/洪水或其他天氣劇烈變動等機率增加，導致廠區或附近社區淹水、設備或廠房使用年限降低或毀壞，且亦有可能造成廠區對外運輸受到阻礙，原物料來源受影響等，導致收入減少或成本上升。	1. 定期維護檢修廠區防水設施。 2. 建立供應鏈原物料備援計劃，避免供應鏈中斷之情況，逐步分散供應商供貨並重視在地採購，減少單一供應商因氣候因素衝擊之因應成本。
	機會	高效率的運輸、配銷、生產流程	中期 (3-10 年內)	優化廢氣、廢水、純水、電力、空壓、空調、冰機、冷卻水、集塵發電機等系統運轉條件，降低其耗用量以降低水電費用等支出。	1. 空壓機變頻系統升級。 2. 照明節能改造，汰換 LED 燈具。 3. 各環安設施保養升級計劃達成率 100%。
		開發/增加低碳產品或服務	中期 (3-10 年內)	1.研發並導入低碳排材料，縮短製程工時及降低水、電用量。 2.與客戶共同合作，從設計面研究精簡製程道數，減少輔材用量，降低生產成本，與客戶創雙贏。	1. 導入新材料 PIC 替代傳統 CVL 材料。 2. 減少油墨印刷面次數，縮短製程工時，減少材料用量。 3. 推廣與提升客戶導入新材料之運用。

項目	執行情形
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	為使公司可掌握當前關鍵氣候機會與風險，永續推動小組每年定期蒐整同業之永續報告書、CDP 氣候問卷之風險機會議題，並向各相關部門單位蒐整年度因應氣候風險之情況，透過訪談各氣候議題相關單位對議題之衝擊程度與發生可能性看法，以彙整並鑑別同泰之年度關鍵氣候風險與機會，將結果於永續小組內討論，並擬定管理及因應策略。 <pre> graph LR A[蒐整議題 ·同業永續報告書議題 ·同業 CDP 問卷 ·國際趨勢] --> B[鑑別風險機會 ·訪談各單位 ·各公司同仁針對風險與機會議題評分] B --> C[擬定因應措施 盤點各營運據點之因應現況，依據各據點之風險機會擬定管理措施] C --> D[追蹤管理 定期會議討論執行策略與指標目標之成效。] </pre>
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	截至年報刊印日止，本公司尚未使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	截至年報刊印日止，本公司尚未有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	截至年報刊印日止，本公司尚未使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎，故不適用。
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相	截至年報刊印日止，本公司非屬於一定條件之公司，故不適用。

項目	執行情形
關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫	截至年報刊印日止，本公司非屬於一定條件之公司，故不適用。

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		(一)本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，規範所有員工在執行公司業務時必須廉能公正及遵守政府法令及規定。董事會成員與管理階層亦秉持誠信的做事原則為公司創業來經營理念。 (二)本公司「誠信經營守則」，載明不誠信行為之防範措施，如：行賄及收賄、提供非法政治獻金、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益、侵害營業秘密及智慧財產權等。 (三)本公司依「誠信經營作業程序及行為指南」之規定，與他人建立商業關係前，應先行評估往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。	無重大差異。
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ (二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ (三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ (四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估	V		(一)本公司依「誠信經營作業程序及行為指南」之規定，若發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。 (二)本公司企業誠信經營之相關宣導及執行由負責單位將不誠信行為、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。 (三)對於利益衝突之相關情事，公司內部員工除可向直屬部門主管報告外，亦可透過「意見箱」及「專用電子郵件帳號」檢舉。 (四)本公司訂有內部稽核計畫，內部稽核單位依據稽核計畫執行各項查核作業，遇有特殊情事發生時，	無重大差異。

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？			會另行安排專案查核。 (五)本公司透過幹部會議及月會，對員工宣導並使員工清楚瞭解其誠信經營理念與規範。	
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		(一)可透過「意見箱」及「專用電子郵件帳號」檢舉相關不誠信行為，並由專責單位人員負責受理。 (二)本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」揭示調查標準作業程序及相關保密機制，其相關文件、資料，均視為機密文件，參與處理的所有人員，對所參與的過程，負有完全保密的責任。 (三)本公司對檢舉人負保密責任，並未對其有任何不當之處置行為。	無重大差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司適時透過公開資訊觀測站、年報等揭露誠信經營相關資訊。	無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：無。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

(八)內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書

同泰電子科技股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：115年2月23日

本公司民國 114 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國114年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國115年2月23日董事會通過，出席董事7人中，全數同意本聲明書之內容，併此聲明。

同泰電子科技股份有限公司

董事長 曾子章

總經理 曾山一

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：不適用

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1. 本公司 114 年股東常會決議事項

項次	股東常會決議	執行情形
1	本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。	已依規定公告申報。
2	本公司 113 年度虧損撥補表案。	股東常會決議通過。
3	辦理減資彌補累積虧損案。	股東常會決議通過，已完成相關作業。
4	修訂本公司「公司章程」案。	股東常會決議通過後，已完成公司章程變更登記。
5	解除本公司第十三屆董事新增之競業禁止限制案。	經股東會許可後解除。

2. 本公司 115 年股東臨時會決議事項

項次	股東常會決議	執行情形
1	修訂本公司「公司章程」案。	股東臨時會決議通過後，已完成公司章程變更登記。

3. 董事會之重要決議事項

會議日期	重要決議事項
114.2.24	1.通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司 113 年度虧損撥補表案。 3.通過本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 4.通過辦理減資彌補累積虧損案。 5.通過本公司辦理現金增資發行新股案。 6.通過修訂本公司「公司章程」案。 7.通過定義本公司「基層員工」範圍案。 8.通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書案。 9.通過本公司 114 年度營運計畫及預算案。 10.通過本公司 114 年度資本支出計畫案。 11.通過本公司 114 年股東常會召開事宜案。 12.通過本公司 114 年股東常會受理持股 1%以上股份之股東提案之期間及地點案。 13.通過提請 114 年股東常會許可本公司第十三屆董事新增之競業禁止限制案。
114.4.21	1.通過本公司財務報表簽證會計師變更及委任案。 2.通過本公司 114 年第一季財務報表案。 3.通過辦理減資彌補累積虧損案。 4.通過評估經理人年終獎金案。
114.7.28	1.通過本公司與第一銀行續簽遠期外匯合約案。
114.10.27	1.通過修訂本公司及子公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 2.通過 114 年度委任會計師簽證財務報表公費案。 3.通過子公司 Uniflex Investment Limited 資金貸與本公司資金貸與案。 4.通過本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞提列比例案。 5.通過評估經理人酬勞案。 6.通過本公司及子公司 115 年度稽核計畫案。
114.11.28	1.通過訂定本公司 114 年現金增資發行價格案。 2.通過本公司 114 年現金增資員工認股辦法案。

會議日期	重要決議事項
114.12.16	1.通過修訂本公司「公司章程」案。 2.通過通過本公司 115 年第 1 次股東臨時會召開事宜案。 3.通過修正定義本公司「基層員工」範圍案。 4.通過本公司出租幼七廠部分土地及廠房給關係人欣興電子股份有限公司案。
115.2.10	1.推選副董事長案。
115.2.23	1.通過本公司 114 年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司 114 年度虧損撥補表案。 3.通過本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 4.通過本公司 114 年度內部控制制度聲明書案。 5.通過本公司 115 年度營運計畫及預算案。 6.通過本公司 115 年度資本支出計畫案。 7.通過本公司 115 年股東常會召開事宜案。 8.通過本公司 115 年股東常會受理持股 1%以上股份之股東提案之期間及地點案。
115.3.19	1.推選董事長案。
115.4.27	1.通過本公司財務報表簽證會計師變更及委任案。 2.通過本公司 115 年第一季財務報表案。 3.通過公司所在地變更案。 4.通過評估經理人年終獎金案。 5.通過提請 115 年股東常會許可本公司第十三屆董事新增之競業禁止限制案。 6.通過新增 115 年股東常會召集事由及更改開會地址案。 7.通過本公司新增出售一批中古設備予同揚光電(江蘇)有限公司案。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

三、會計師公費資訊

(一) 簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	陳憲正	114 年度	2,790	930	3,720	(註)
	林冠宏					

註：非審計公費：主係稅務簽證公費、英文財報翻譯、減資查核公費及永續報告顧問費。

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

四、更換會計師資訊：無此情形。

五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無此情形。

六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一) 董事、經理人及大股東股權變動情形

職稱	姓名	114 年度		115 年 截至 4 月 27 日止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長	欣揚投資(股)公司	(4,934,637)	-	-	-
	代表人：簡山傑(註 1)	-	-	-	-
董事	欣揚投資(股)公司	(4,934,637)	-	-	-
	代表人：郭政輝	-	-	-	-
董事	欣揚投資(股)公司	(4,934,637)	-	-	-
	代表人：鍾明峰	263,000	-	-	-
董事/總經理	曾山一	586,908	-	-	-
獨立董事	李松山	-	-	-	-
獨立董事	曾雯如	-	-	-	-
獨立董事	張淑如	-	-	-	-
資深副總經理	李光偉	300,410	-	-	-
財會處長	蔡文程	159,871	-	-	-
協理	田鷹(註 2)	-	-	-	-
協理	趙永興(註 2)	-	-	-	-
大股東	欣興電子(股)公司	377,281	-	(132,000)	-

註 1：於 115 年 3 月新任。

註 1：於 114 年 10 月新任。

(二) 股權移轉之相對人為關係人者資訊：無。

(三) 股權質押之相對人為關係人者：無。

七、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

115 年 4 月 27 日 單位：股 / %

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
欣興電子股份有限公司(欣興)	13,234,997	15.37%	-	-	-	-	欣揚	欣揚之母公司	
欣揚投資股份有限公司(欣揚)	5,950,528	6.91%	-	-	-	-	欣興	欣興之子公司	
台灣表面黏著科技股份有限公司	4,075,105	4.73%	-	-	-	-	-	-	
劉益汶	3,615,607	4.20%	-	-	-	-	-	-	
高漢隆	2,010,939	2.34%	-	-	-	-	-	-	
陳碧惠	1,142,029	1.33%	-	-	-	-	-	-	
曾山一	979,086	1.14%	-	-	-	-	-	-	
呂明富	924,640	1.07%	-	-	-	-	-	-	
黃榮安	789,355	0.92%	-	-	-	-	-	-	
李光偉	748,096	0.87%	-	-	-	-	-	-	

八、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

114 年 12 月 31 日 單位：仟股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Uniflex Investment Limited	22,517	100.00	-	-	-	100.00
同揚光電	註 1	100.00	-	-	註 1	100.00
Uniflex Group Limited	1,100	100.00	-	-	-	100.00

註 1：均為有限公司，因此無記載股數。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股本形成經過

單位：股/ 新台幣元

年/月	發行價格	核定股本		實收股本		備 註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
114/8	10.0	450,000,000	4,500,000,000	53,113,769	531,137,690	彌補虧損 440,460,240 元	無	註 1
115/2	12.5	450,000,000	4,500,000,000	86,113,769	861,137,690	現金增資 330,000,000 元	無	註 2

註 1：(114)經授商字第 11430100690 號函

註 2：(115)經授商字第 11530004140 號函

2.股份種類

單位：股

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未 發 行 股 份	合 計	
記名普通股	86,113,769	363,886,231	450,000,000	保留 20,000,000 股供發行員工認股權憑證之轉換股份

3.總括申報制度相關資訊：無。

(二)主要股東名單

115 年 4 月 27 日 單位：股

股份 主要股東名稱	持 有 股 數	持 股 比 例
欣興電子股份有限公司	13,234,997	15.37%
欣揚投資股份有限公司	5,950,528	6.91%
台灣表面黏著科技股份有限公司	4,075,105	4.73%
劉益汶	3,615,607	4.20%
高漢隆	2,010,939	2.34%
陳碧惠	1,142,029	1.33%
曾山一	979,086	1.14%
呂明富	924,640	1.07%
黃榮安	789,355	0.92%
李光偉	748,096	0.87%

(三)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策

本公司因考量公司所處環境，分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。股東股利之發放，

其中現金股利於股利總額之 10%~100%，股票股利於股利總額之 0%~90%。

2.本次股東會擬議股利分配之情形：本年度經董事會決議不分派股利。

3.預期股利政策重大變動：無。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本公司 114 年度無配股，故無影響。

(五)員工及董事酬勞

1.公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司公司章程所載，公司年度如有獲利(即稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益)，應提撥不高於 2%為董事酬勞及 1%~20%為員工酬勞，但公司尚有累積虧損時，應先予以彌補。

前項員工酬勞數額中，應提撥 1%~20%為基層員工分派酬勞。員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。

員工酬勞及董監酬勞分派案應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之並提股東會報告。

2.本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司 114 年度經董事會決議不配發員工及董事酬勞，與帳列之估列基礎並無差異。本公司並無以股票分派之員工酬勞，故無影響。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額：本公司經董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞，與認列費用年度估列金額無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司經董事會決議不分派員工酬勞。

董事會通過員工酬勞案並無配發員工股票酬勞，故不適用。

4.前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形：

本公司 113 年度無分派員工及董事酬勞，故不適用。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證之辦理情形：無。

五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形：無。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

七、資金運用計劃執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.公司所營業務之主要內容

- (1)CC01080 電子零組件製造業。
- (2)CC01060 有線通信機械器材製造業。
- (3)F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- (4)F113070 電信器材批發業。
- (5)F401010 國際貿易業。
- (6)CA04010 表面處理業。
- (7)CA03010 熱處理業。
- (8)CA01050 鋼材二次加工業。
- (9)除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2.營業比重

單位：新台幣仟元；%

年度 產品別	113 年度		114 年度	
	金額	%	金額	%
軟性印刷電路板	1,965,601	99.97	2,143,229	99.92
其他	539	0.03	1,800	0.08
合計	1,966,140	100	2,145,029	100

3.公司目前之商品(服務)項目

本公司主要從事多層及軟式印刷電路板(Flexible Print Circuit; FPC，以下簡稱軟板或 FPC)之製造加工與買賣業務，亦提供客戶表面零件黏著(Surface Mount Technology, SMT)之服務。本公司主要產品應用領域如下：

- (1)汽車電子相關應用領域
- (2)eReader、eNote、ESL、PAD、NB、Mobile Phone 相關應用領域
- (3)工控相關產品
- (4)高速/高頻產品相關應用領域
- (5)元宇宙 Metaverse 概念產品相關應用領域
- (6)醫療健康與健身等產品相關應用領域
- (7)無人機等產品相關應用領域
- (8)遊戲機產品相關應用領域

4.計畫開發之新商品(服務)

電路板隨著電子系統的複雜度提高，除了朝向輕、薄、柔軟、可摺等特性發展變革，且為因應其客製化需求，客戶端整合服務亦為開發趨勢，本公司研發中心積極配合客戶開發於節能、綠能、智能等產品的需求，且兼顧行動性及客製化設計，積極配合客戶持續朝降低生產成本、增加產品附加價值、提升產品特性及縮短製程開發、生產時程，投入新技術發展如下：

- (1)高速高頻電路板訊號傳輸技術開發
- (2)低能耗及高精度軟性電路板製程開發研究

在開發商品新應用領域方面，本公司為因應消費性電子市場價格競爭激烈之態勢，擬開發或進行中開發利基型市場之軟板應用領域如下：

- (1)汽車電子之軟性印刷電路板
- (2)eReader、eNote、ESL、PAD、NB、Mobile Phone 之軟性印刷電路板
- (3)工控相關之軟性印刷電路板
- (4)高速/高頻產品之軟性印刷電路板
- (5)元宇宙 Metaverse 概念產品應用之軟性印刷電路板
- (6)醫療健康與健身等相關之軟性印刷電路板
- (7)無人機等產品之軟性印刷電路板
- (8)遊戲機產品之軟性印刷電路板

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

A. 全球軟性電路板(Flex)需求穩定成長

依據市調機構 PRISMARK 數據，113 年全球 PCB 產值預估年增 5.5%，114 年將進一步成長 6.2%。其中，HDI 與 IC 載板的年複合成長率 (CAGR) 分別達 7.8%和 7.6%且 113-117 年整體複合年增率約 5.6%，117 年 PCB 產值可達 911 億美元，顯示產品需求持續增長。

B. 114 年仍面臨國際地緣政治及全球經濟循環波動，但持續受益於技術創新及多元應用需求推動

109 年初疫情使 PCB 產量一度受阻，但隨疫情緩解及宅經濟帶動如 5G、筆電、遊戲機需求成長，110、111 年產值持續攀升。112 年因國際衝突、高通膨等因素，終端產品需求下降，PCB 產值短暫衰退。但 114 年全球經濟回穩，PCB 產業產銷動能回升，受 AI、高速運算與網通設備需求帶動整體產值回穩並成長。

另，因應美中貿易摩擦及烏俄戰爭帶來的全球供應鏈不確定性，PCB 製造商調整投資策略，資本支出趨於審慎，並積極布局東南亞等新興產能基地，強化供應鏈韌性和風險分散。台灣 PCB 產業 114 年資本支出預計減少，但投資聚焦 AI 伺服器高階產線及東南亞產能擴充。

綜上所述，PCB 行業在疫情後和地緣政治變動中調整供應鏈與投資策略，技術升級與需求結構轉變（如 AI 伺服器、高階應用）成為成長主力。雖存在市場波動與不確定因素，但 114 年行業產值整體向上，展現韌性與轉型動能。

C. 軟式印刷電路板產業現況

本公司為軟性印刷電路板(Flexible Print Circuit, FPC；以下簡稱軟板)之專業製造商，主要從事顯示器模組(LCM)、LED 背光源模組、觸控螢幕模組及車載用等領域之軟板生產。軟性印刷電路板為印刷電路板(Printed Circuit Board, PCB)之細項產業，主係作為各種電子零組件在安裝、互連及訊號和電流連結之平台，是所有電子產品不可或缺的基礎零件。軟式印刷電路板相對於硬式印刷電路板而言，具有可連續自動化生產、可提高配線密度、量輕、體小、具可撓性、設計領域大、可以三次元立體配線、能省略接線器、電線之焊接等優勢，使產品符合輕、薄、短、小之需求。

PCB 製造業主要可區分為上游的銅箔基板，中游的印刷電路板、IC 載板，以及下游的印刷電路板加工，其中印刷電路板可進一步區分為多層板、軟板、高密度互連板(HDI)板等產品，主要應用產品包括智慧型手機、筆記型電腦、汽車、穿戴式裝置、伺服器等產品。

近年來下游終端產品更強調輕薄短小且功能多元的特性，包括電子

書、電子標籤、智慧型手機、平板及筆記型電腦、高速/高頻產品等相關產品以及穿戴式裝置，在有限的空間下帶動許多元件功能模組化，例如液晶螢幕模組，相機鏡頭模組，LED 背光源模組等，其內部電路設計也相對複雜，對於各模組功能需有軟板作為導體，故對於各模組層次發展出各自適用之軟板，如 LED 背光源軟板、LCM 用軟板。而上游材料特性、廠商製程、技術層次左右了軟板產品品質良莠，例如 LED 背光源軟板所需技術層次較強調耐熱性，而手機鏡頭模組軟板則強調高曲折性，因此軟板產業相當講求上、中、下游廠商之完整性與配合度。

一般而言，軟板主要用於主機板和外部元件的連結，過去一支功能性手機使用軟板的數量約為 3~5 片，NB 使用軟板的數量約為 3~7 片，由於現今電子產品要求輕薄且功能更加多元，使得智慧型手機軟板需求達 12~15 片，是傳統手機的 2 倍以上，平板及筆記型電腦軟板使用量達 15~20 片，穿戴式裝置產品則受限尺寸約使用 2~3 片軟板。由於電子書、電子標籤、智慧型手機、平板及筆記型電腦及穿戴式裝置產品的熱銷，且加上電子產品趨於薄型化的設計，未來將持續帶動軟板的整體應用和需求。

全球軟性印刷電路板(FPC)市場經歷了疫情期間的大幅成長與隨後的調整波動。市場規模：110 年全球 FPC 產值達約 200 億美元高點，此後 111 年略降至約 196.9 億美元。112 年受終端需求趨緩、庫存調整影響，市場明顯下滑至約 183.6 億美元。113 年在電子書、電子標籤、手機、個電市場復甦和車用需求增長帶動下，市場呈現回溫，預計回升至 197 億美元，使 113 年重回正成長，TPCA 指出，隨著 AI 應用在手機與電腦市場逐漸普及，電動車持續擴展，軟板需求有望持續升溫。

進入 114 年，儘管全球面臨關稅政策與終端需求的波動等不確定因素，全球軟板產業仍維持成長態勢，市場規模擴大至 200.8 億美元，年成長 6.4%，成功突破 200 億美元大關。在應用結構方面，手機市場受關稅、經濟不確定性及二手市場擴張影響，全球出貨量預估僅增長 0.6% 至 12.4 億支；但 AI 技術的滲透為產業注入了全新動能。AI 技術持續下放至中階機種，114 年 AI 手機出貨量達 4.458 億支，滲透率接近 37%，有效推升軟板用量與整體產值成長。此外，AI 眼鏡作為軟板應用的新興焦點，114 年全球出貨量飆升至 870 萬台，同比大幅增長 322%，為軟板在設計精度、材料散熱與耐用性上提出了更高要求，也為軟板廠商開啟了高附加價值市場。

展望 115 年，軟板產業的核心動能將聚焦於 AI 手機的持續滲透與折疊手機的加速普及。DIGITIMES 預估，AI 手機出貨量將從 114 年的 4.458 億支成長至 115 年近 6 億支，占全球智慧手機出貨量接近半數，在記憶體、散熱系統及神經處理單元方面的全面升級，將持續推動高階軟板需求。同時，隨著蘋果首款折疊 iPhone 與三星三折迭機型的推出，折疊手機市場可望迎來爆發性成長，IDC 預估 115 年折疊手機增幅有望升至 30%，出貨量上看 2,680 萬部，帶動高耐折軟板需求大幅提升。總體而言，AI 與折疊技術將持續驅動手機內部軟板用量與價值的同步提升，AI 手機與折疊手機等新型態產品的滲透率提升，將成為 115 年推動高附加價值軟板市場穩定成長的關鍵引擎。

D. 軟板應用領域

軟性印刷電路板(FPC)應用領域廣泛，涵蓋電子書、電子標籤、智慧手機、平板電腦、筆記型電腦、可穿戴裝置、汽車電子及工業設備等

多個領域。其中，智慧手機依然是最大的應用產品。根據 TPCA 與工研院產科國際所發布之《114 全球軟板產業觀測》報告，113 年全球軟板產值達 188.7 億美元，年增 2.8%，114 年市場規模進一步擴大至 200.8 億美元，年成長 6.4%，手機為最大應用類別，佔比高達 55.8%，廣泛應用於顯示觸控模組、相機模組、天線及連接排線等；非手機應用方面，電腦占 18.3%、汽車占 15.8%、穿戴式裝置占 6.7%。

隨著 5G 時代來臨及 AI 應用逐步普及，智慧手機內建高速天線與多攝影頭配置日益複雜，單機 FPC 的用量與價值同步提升。114 年全球智慧手機出貨量約 12.4 至 12.5 億支，年增約 1.0% 至 1.5%，其中 AI 技術持續下放至中階機種，AI 手機滲透率達 37%，出貨 4.6 億支，有效推升軟板用量與整體產值成長。摺疊手機方面，114 年全球出貨量達 2,060 萬部，年增 10%。

展望 115 年，受儲存晶片價格上漲推升平均售價至歷史高點影響，IDC 預估 115 年全球智慧手機出貨量將下滑 0.9% 至約 12.4 億支，Counterpoint Research 亦預估年減 2.1%。然而，AI 手機出貨量仍將逆勢成長，DIGITIMES 預估將從 114 年的 4.458 億支成長至 115 年近 6 億支，滲透率接近半數。摺疊手機在蘋果首款摺疊 iPhone 與三星三摺疊機型帶動下，115 年增幅有望升至 30%，出貨量上看 2,680 萬部，市場關注度與消費吸引力可望再度提升。整體而言，儘管 115 年手機整體出貨面臨短期壓力，但 AI 手機與摺疊手機等新型態產品的滲透率持續提升，預期將持續推動高階軟板用量與整體產值穩步成長。

根據 Prismark 的調查，在軟板市場結構中，除智慧手機外，平板電腦與筆記型電腦占約 19%，汽車應用則約為 14.6%，消費電子及其他應用約佔 11.6%。隨著智慧手機功能持續擴展，每台手機內軟板使用量增加，但因市場飽和，整體需求成長面臨瓶頸。然而，5G 及毫米波技術的普及，不僅推動 5G 手機內高速、高頻天線及鏡頭模組軟板需求攀升，更使應用場景擴展至衛星通訊、車聯網與穿戴裝置等新興領域。因應此趨勢，國內外軟板及材料廠商積極投入高頻高速傳輸技術與材料研發，搶攻高頻傳輸市場的龐大商機。

在材料與製程技術方面，高頻高速傳輸需求驅動銅箔、介質材料與覆蓋膜持續升級，以提升信號完整性與熱管理效能；同時針對汽車電子及工業設備等高穩定性應用，軟板的可靠性測試標準日趨嚴格。環保與可持續發展方面，全球環保規範加嚴，FPC 產業逐步推動綠色製造及材料回收，低揮發性有機化合物（VOC）材料及無鹵素基板成為趨勢，配合節能減碳製程，滿足企業社會責任及市場環保需求。

此外，軟板產業供應鏈環環相扣，面臨原物料價格波動及地緣政治風險影響。疫情後全球供應鏈重組，業者積極布局多元供應來源與在地化生產，以提升抗風險能力。未來展望部分，除了持續聚焦 5G 與毫米波技術，電動車自動駕駛及物聯網（IoT）裝置對超薄、柔韌且高密度軟板需求迅速增長，推動多層 FPC、高頻高速訊號隔離及 3D 軟板結構等高階技術發展。

近年來，汽車電子尤其是電動車（EV）領域成為 FPC 產業重要的成長推手。據 Persistence Market Research 統計，114 年全球車用 PCB 市場規模約為 103.97 億美元。其中，電動車的快速滲透帶動 PCB 價值大幅提升，純電動車（BEV）每輛車的 PCB 價值約為傳統燃油車的 5 至 6 倍。電控系統為車內 PCB 中價值最高的部分，約占一半，但目前 BMS（電

池管理系統)仍主要採用線束連接。在電動車輕量化趨勢推動下，FPC正逐步取代傳統BMS(電池管理系統)中的線束連接方案，114年新能源汽車用FPC全球市場規模達約15.13億美元。目前車用FPC佔車用PCB比重約17%，預計115年將上升至20%，進一步推動車用軟板市場規模擴大。同時，FPC在車載資訊顯示、感測器、照明等領域的應用也日益普及，讓汽車電子成為FPC產業的重要增長點，有效抵消手機等傳統消費性電子產品需求放緩帶來的衝擊。

面對全球智慧手機市場趨近飽和，台灣軟板廠積極尋求新的成長機會，聚焦於蓬勃發展的電動車與自動駕駛市場。隨著汽車電子化程度提升及車輛輕量化需求，FPC逐步替代傳統線束，用量與使用面積均顯著增加。台廠雖然目前車用軟板營收占比較低，但普遍看好其長期成長潛力，持續加碼產品與技術布局。此外，配合元宇宙熱潮與高速傳輸技術的發展，VR/AR及混合實境(MR)裝置對於輕量化和多軟板連接的需求快速成長。此類裝置涵蓋螢幕、鏡頭、系統單晶片(SoC)、主機板及感測器，利用軟板的柔韌性改善佩戴舒適度並提高感測器靈活度，助力數據蒐集與體感模擬，結合5G及Wi-Fi 6等高速傳輸，帶動高頻高速軟板需求擴大。品牌廠商紛紛推出新一代VR/AR/MR產品，推升軟板市場進一步成長。

隨著AI時代來臨，伺服器與高性能運算對FPC需求持續增長。資料中心與高階運算設備內部高速連接，需低延遲、高頻傳輸，傳統線束逐漸被高速柔性電路取代。114年全球伺服器PCB市場規模已突破90億美元，AI伺服器為成長核心引擎，115年可望翻倍成長。終端裝置如智慧手機、筆電為強化AI運算，亦增加感測與傳輸模組，擴大FPC用量。整體而言，雲端與終端雙重驅動推升高速高密度軟板市場需求。

此外，穿戴裝置(智慧手錶、無線耳機、AR/VR)因輕薄可彎特性廣泛採用FPC；工業與服務型機器人需柔性連接以提升動作靈活和可靠性；無人機追求輕量與抗震，也逐漸改用軟板延長續航與耐振動。摺疊手機鉸鏈處對軟板反覆折疊壽命要求嚴苛，促使廠商研發高耐彎性材料與結構強化技術。

綜上所述，FPC應用正從傳統資訊通信擴展至汽車電子、無人機、物聯網與各類新興智慧裝置，市場前景廣闊。

2.產業之未來發展趨勢

114年至119年全球FPC市場預計以約10.8%至13.7%的複合年增長率擴大，119年市場規模有望達到350億美元以上。主要驅動力來自汽車電子、通訊、穿戴裝置、機器人、無人機及物聯網設備的需求激增。

3.產業上、中、下游關聯性

本公司位居於產業鏈之中游，如圖 1 之軟板上下游關係圖，上游為軟性印刷電路板組成之原料，下游終端需求廠為系統廠及各類電子產品製造廠，以下茲分別來做敘述。

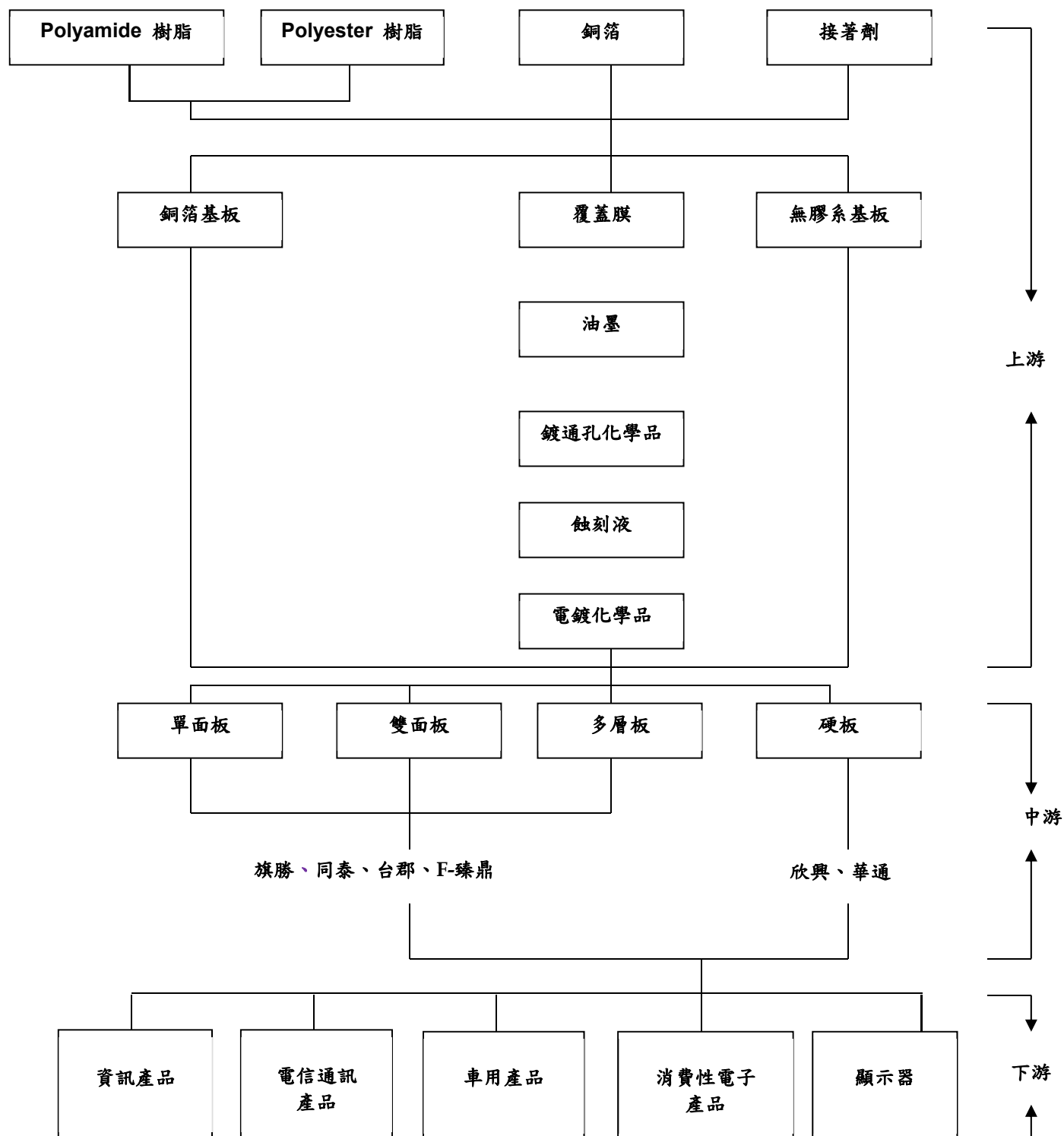


圖 1 軟板產業之上、中、下游關係圖

(1)上游

軟板的構造主要由軟性銅箔基板(Flexible Copper Clad Laminate, FCCL)以及保護膜(Cover Layer)所組成，FCCL 主要材料為銅箔以及聚醯亞胺樹脂(Polyimide Resin, PI)；保護膜主要材料亦為聚醯亞胺樹脂(Polyimide Resin, PI)，其主要關係為：由銅箔和 PI 先製成 FCCL，再由 FCCL、保護膜、補強板、防靜電層等材料製成軟板。

(2)中游

中游軟板廠主要將自上游廠進貨之軟性銅箔基板進一步加工為各種軟板產品，包括單面板、雙面板以及多層板等。其又可依客戶別不同而有所區分，以模組廠作為主要下游客戶，多為專業軟板供應商，其特性為能彈性生產，提供快速服務及終端產品應用多元；而以系統廠作為主要下游客戶多為資本規模較大及能提供客戶一次購足服務之軟板供應商，其特性為設備資本支出大，需配合客戶具備高度量產能力及大量的 SMT 設備。目前全球主流軟板大廠皆以系統廠或其協力廠商作為主要客戶，其終端產品多為主流消費性電子產品，在全球對其需求量大之驅動下，帶動上述軟板大廠之整體營收規模。

(3)下游

待軟板經由表面黏著製程使可發揮其訊號相連之作用，其便會交與下游之系統組裝廠或品牌廠進行進一步之電子產品之組裝。目前主流軟板之需求系統廠多為電子書、電子標籤、智慧型手機、手錶、平板、LED 電視、LED 背光源電腦等，國際大廠如 Apple、Samsung，國內大廠如 ASUS、GARMIN 等，其產品需求帶動了軟板產業之發展。台灣在下游產業耕耘多年，帶動整體電子零組件產業之發展，雖特定高階上游原物料仍需仰賴日系大廠、國內主要軟板龍頭廠亦面臨高度集中單一下游客戶之情形，些許降低營運彈性，但整體而言，國內的軟板產業上、中、下游體系鏈相當完整。

4.產品之各種發展趨勢

FPC 技術正朝向高密度、車用與高頻高速方向演進，各應用的新需求推動產品升級，其產品之發展趨勢主要如下：

(1) 超細線路軟板及多層軟板

智慧裝置小型化與高功能密度要求軟板線寬/線距不斷縮減，先進製程已可量產 30 μ m/30 μ m 線寬線距，並正向 25 μ m 級邁進；部分領先廠商(如臻鼎)甚至宣稱達到 10 μ m 線寬試產能力。同時軟板層數持續增加並引入 HDI (高密度互連) 結構，多階盲孔、多層堆疊設計日益普遍，以提升布線密度。然而更微細的導線和更多層疊也帶來製程挑戰，例如盲孔填孔及板材撓曲可靠性等需克服。整體而言，超細線、多層化軟板技術將成為未來主要發展方向，用於高階智慧型手機主板、相機模組、AR/VR 裝置等高密度模組連接。

(2)高反射率 LCD 用軟板燈條(Light bar)

隨著顯示面板背光技術升級，軟板在 LCD/LED 背光源中的應用受到重視。傳統 FPC 基材(褐色或黃色)對光有一定吸收，新一代高反射率軟板透過使用白色覆蓋膜等材料，提高對 LED 背光的反射效率，可大幅提升背光亮度與能源效率。這類軟板燈條廣泛應用於筆電、TV 的背光模組中，滿足高亮度、低功耗的顯示需求。

隨著 Mini LED 背光技術於近年興起，高反射軟板燈條的需求進一步提升。Mini LED 背光在電視、專業顯示器和蘋果高階平板/筆電上逐步導入，其特點是使用大量密集排列的 LED 區域調光，以提供高亮度高對比的顯示效果。以蘋果 110 年推出的 12.9 吋 iPad Pro 為例，即採用約 1 萬顆 Mini LED 背光，分成 2500 區控制。如此大數量 LED 需要高效的軟板作載體，以確保亮度和能源

效率。台灣透過改進白色阻焊材質和軟板佈局，實現高反射、高均勻度的背光燈條，滿足客戶對亮度與省電的苛刻要求。

在大尺寸 LCD-TV 領域，韓系與大陸面板廠也積極採用 Mini LED 背光以對抗 OLED 電視，高反射軟板燈條同樣是關鍵部件，帶動相關 FPC 供應商出貨成長。根據市場研究公司 Omdia 最新的《Mini-LED 背光市場追蹤》顯示，到 113 年配備 mini-LED 背光單元的電視顯示器出貨量將達到 620 萬台，到 114 年，Mini-LED 背光電視出貨量預計將達到 930 萬台，首次超過 OLED 電視的 750 萬台。

(3)車用(含新能源)電子產品之軟性印刷電路板

汽車電子化浪潮為軟板開闢新的成長動能。傳統汽車中軟板多用於照明、感測器、車載資訊娛樂等系統的線束替代品。隨著電動車（EV）普及，電池管理系統 BMS 成為新增應用；軟板用於電池模組連接，可取代笨重的線束，在相同載流下減輕約 70% 重量且節省大量空間。此類電池軟板尺寸遠大於消費性軟板，製程精度與良率控制成為關鍵技術課題。此外，先進駕駛輔助(ADAS)、智慧座艙等汽車新功能也大量採用 FPC，以因應車內有限空間和彎曲設計需求。預計隨 ADAS、車內顯示屏等滲透率提高，軟板用量將持續攀升。業界預估車用軟板市場未來幾年年增率可望達 10%。

據 TrendForce 研究顯示，受惠于全球電動車滲透率持續提升及汽車電子化程度提高，車用 PCB 市場於 112 年產值預估年增 14%，達 105 億美元，占整體 PCB 產值比重由 11% 上升至 13%。展望未來，預計至 115 年車用 PCB 產值將有望成長至 145 億美元，占整體 PCB 產值比重上升至 15%，111 年至 115 年車用 PCB 產值年複合成長率(CAGR)約 12%。同時，車用 PCB 產品結構持續向高階化發展，預估 HDI 板比重將由 112 年的 15% 成長至 115 年的 20%，FPC 板比重將由 17% 上升至 20%。

其中相當一部分增長來自軟板在車上的滲透提升。日本廠商在車用 FPC 長期居於領導：Nippon Mektron 早在混合動力車時代即供應電池監控 FPC，並宣稱在車用 BMS 軟板領域擁有全球最高市佔，日本其他廠如住友電工、藤倉電氣等也有提供車載鏡頭、天線用 FPC；中國和台灣業者近年亦積極投入車用市場：東山精密收購車載顯示廠、擴充新能源車軟板產線；臻鼎科技與汽車 OEM 合作開發產品。南韓方面，過去車用軟板多由日系供應，韓廠占比有限，但隨 Hyundai 等韓國本土電動車發展，韓國軟板廠也在爭取機會。

(4)高速/高頻訊號傳輸軟板

面向 5G 和高速運算，FPC 材料與設計加速演進。在手機射頻方面，進入毫米波頻段後傳統改良 PI (MPI) 材料耗損較大，當頻率升至 28GHz、39GHz 以上時，需採用液晶高分子 (LCP) 或氟系高頻材料製作軟板天線，以降低損耗。例如 iPhone 天線模組已採用 LCP 軟板，滿足 5G 時代高頻高速傳輸需求。

除手機外，高速傳輸介面也是軟板高頻化的重要應用。現代筆電、平板內部的高速連接為節省空間常以軟板連接，但若走高速數據時，傳統 PI 軟板難以勝任，高速介面 FPC 正改用 MPI 甚至 LCP 材質，搭配加粗銅箔和精密阻抗控制來確保訊號完整性。在資料中心和高性能運算設備中，為了克服 PCB 走線距離的限制，有些廠商採用「高速線纜替代(Flyover)」方案，以軟板來充當板對板的高速連接通道。這種軟板高速連接器通常使用低損耗的 LCP 基材，將伺服器主板和高速子卡（如 AI 加速卡）直接以柔性扁平線連接，減少傳輸損耗與延遲。隨 AI 伺服器對高速互連需求飆升，相關高速 FPC 連接方案開始受到關注，台廠如台郡等已佈局 AI 伺服器用高速軟板產品線。

總體而言，支援高速、高頻的軟板（如 LCP 柔性天線、傳輸線）將在 5G

智慧型手機、AI 裝置、資料中心等領域扮演日益重要的角色。

(5)其他新興應用

穿戴式裝置、機器人、摺疊設備等新興市場也為 FPC 帶來增量需求。穿戴裝置（如智慧手錶、無線耳機、AR/VR）強調輕薄可彎，FPC 因具耐折曲、輕量和高度集成優勢，成為設計核心。服務/工業機器人的關節和視覺模組需要可隨動作彎曲的连接，FPC 是理想方案，可提升機器人柔性和可靠性。無人機領域，為追求輕量與抗震，越來越多控制電路改用軟板，有助於延長續航並耐受飛行振動。此外，摺疊手機的鉸鏈處必須使用高耐折的軟板連接上下螢幕，這類產品對 FPC 的反覆折疊壽命提出更高要求，驅使廠商研發新的材料與結構。

5.競爭情形

根據 TPCA 與工研院產科國際所資料顯示，114 年美國 PCB 市場規模已達 40.1 億美元，全球市占率 4.2%，排名全球第五。主要產品包括多層板與 HDI 板，應用於國防航太、工業控制及醫療設備等高附加價值市場。美國政府近年透過國防授權法案及晶片與科學法案，推動產業本土化。例如，TTM 公司在紐約州投資設廠以生產 UHDI 板材，滿足軍工需求。然而，美國本土 PCB 產能有限，進口依賴台灣與中國大陸。展望 115 年，受惠於國防訂單挹注及資料中心等基礎建設需求的強勁推動，美系 PCB 業者產值有望再成長一成，突破 44 億美元大關。

同時，歐洲 PCB 市場規模在 114 年約為 26.7 億美元，占全球市場 2.8%。其中，奧地利 AT&S 公司在高階載板領域表現出色，產品廣泛應用於汽車、半導體及工業控制市場。但整體而言，歐洲 PCB 產業仍面臨高昂的勞動力和能源成本挑戰，地緣政治衝突持續加劇能源價格波動，且產業技術轉型速度相對緩慢，限制其整體競爭力。

為了提升歐洲的 PCB 產業，歐盟於 113 年 3 月提出 Full European HDI PCB and Assembly Supply Chain for Space and Industrial Segments(簡稱 FOUCSING)，寄望為歐盟在太空和工業領域，建立具有競爭力、可持續性與獨立性的 PCB/HDI 及組裝供應鏈，透過技術創新與政策支持，鞏固其市場地位。

TPCA 指出，為推動本土製造業，印度採取對手機與電動車產品課稅等政策，吸引外資設廠，部分中國大陸廠商已逐步在印度設立生產線，若持續發展，相關供應鏈如 PCB 廠商也勢必將隨著終端廠商遷移，但印度製造業仍面臨多重結構性瓶頸，例如基礎設施不足、電力供應不穩、人才短缺及供應鏈高度依賴鄰國等問題，限制了 PCB 產業的發展。

另外，印度雖然對大陸 PCB 產品課徵反傾銷稅，但僅針對 6 層 PCB 產品，也反映出印度本土 PCB 產業尚無法支撐中高階 PCB 製造需求。印度 PCB 市場仍高度依賴進口，進口占比高達 88%，印度 PCB 產值占全球市場比重仍相對有限。因此，如何克服結構性瓶頸，提升產業競爭力，將成為印度政府推動製造業升級的關鍵課題。

全球矚目東南亞 PCB 新聚落即將成形，TPCA 指出，隨著中美貿易戰與科技戰的升溫，東南亞憑藉低成本與東協市場規模，其中尤其以泰國、越南與馬來西亞三國受到全球各國 PCB 指標企業的投資青睞，東南亞將成為 PCB 重要的新生產聚落，也是一個全新戰場。

114 年泰國 PCB 產值達 39 億美元，年增率 11.4%，占全球市場比重約 4.6%，為東南亞最大的 PCB 生產國，早期為日本 PCB 廠的海外生產基地，在地緣政治驅使終端客戶對其供應鏈 China+1 的要求下，泰國政府順勢推出多項投資優惠政策，並依據投資重要性、技術與規模，可享最高 8 年免稅優惠，至今已吸引超過 40 家來自中國大陸與台灣 PCB 廠赴泰投資，預計短期內將成

為東南亞最大的 PCB 生產聚落。

全球重要手機、筆電等電子製造中心的越南，早已吸引多家日韓 PCB 廠商如 Nippon Mektron、Meiko 及 SEMCO 投資建廠，TPCA 指出，114 年越南 PCB 產值約為 34 億美元，年增率 9.7%，占全球市場約 4%，居東南亞第二大 PCB 聚落。為進一步強化電子產業鏈，越南推出包括「4 年免稅、9 年減半」在內的多項優惠政策，吸引中國大陸的勝宏、建滔、駿亞及台灣健鼎、志超等企業布局，然而，越南的電力基礎設施過度依賴水力發電，季節性缺電問題嚴重，成為越南亟需解決的挑戰之一。

馬來西亞 PCB 產值達 22 億美元，年增 10.0%，占全球約 2.6%。在地緣政治驅動下在全球封測市場中占有 13% 的比重，已然成為全球半導體封測之關鍵樞紐。其 PCB 產業主要集中於載板領域，核心聚落位於檳城和鄰近的居林，包括 AT&S、Ibiden、TTM 及 ASE 等廠商在內的龍頭企業均在此設點。

但由於馬國專注於半導體領域，內需 PCB 供應高度依賴進口。TPCA 指出，為促進 PCB 產業發展，馬來西亞投資發展局針對高科技企業提供高達 5 年、100% 的所得稅減免優惠，吸引精成科(6191-TW)、明陽電路及 CCL 廠商台光電(2383-TW)等企業投資。然而，目前馬來西亞 PCB 產業在材料與設備供應上仍仰賴中國大陸與台灣，未來需要進一步強化基礎設施及供應鏈整合能力。

TPCA 認為，全球新賽局 PCB 產業走向多元競爭格局，PCB 產業的發展格局正隨著地緣政治和產業政策的重組，展現出區域化競爭特色。美歐國家聚焦高附加值產業與自主供應鏈發展，印度則因基建與人才瓶頸，發展潛力尚未完全釋放；而東南亞尚能依託成本優勢和優惠補貼，快速崛起為全球供應鏈重組的最大受益者。

目前本公司主要營收項目為車用軟板、高頻高速相關產品、顯示螢幕相關軟板、工控相關軟板、超高反射 Light Bar 及一般消費型 Light Bar 等軟板生產，定位為專業板廠，其終端客戶多領域、產品種類多元化，致生產排程彈性高、交期極其穩定、多樣化產品整合服務為本公司之競爭優勢。著眼 Light Bar 等產品領域當前競爭激烈、毛利漸低之際，本公司目前積極開發新製程，新的材料應用及專利，並與多家廠商建立戰略合作關係，不僅在技術上進行交流，亦相互協助開發新客戶，本公司為開發新市場及新應用，未來將市場焦點著重在車用、5G 天線及傳輸線、工控及高反射 Light Bar 相關產品應用領域，以期開創和國內競爭廠商之不同市場區隔，建立自我競爭優勢。

(三)技術及研發概況

1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	114 年度
研發費用	82,593	78,733
營業收入	1,966,140	2,145,029
研發費用佔營業收入比例(%)	4.20	3.67

2.最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

本公司致力於新產品及先進製程的開發及擴產，研究方向以多元且高附加價值的產品領域、並融合多項已開發技術，朝提升生產技術能力邁進，如 5G 高頻高速傳輸產品擴產、ESG 低碳排新材料開發運用、微孔高導熱產品擴產、高反射立體紋路等產品運用。

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期計畫

本公司未來策略主軸還是繼續朝高附加價值之利基市場邁進，除原先車用電子領域繼續擴大，繼續延續高頻材料的軟板開發製造，另外配合客戶共同開發新產品，以滿足客戶之需求。

2.長期計畫

本公司以交期彈性、快速服務、多樣化產品整合服務為主要優勢，長期致力於生產製程之提升、技術精進，具體而言，本公司之長期製程計畫如下：

- (1)多層板製程：強化多層板 FPC 的量產能力，開拓多元而高階的產品領域，大幅提高生產技術能力。
- (2)直接作業製程：軟板尺寸安定性較大，生產需準備多組底片、網板或模治具工具，過程極度費時、耗力，導致生產效率降低，因此投入開發自動化設備，全程由設備自動生產化作業，全面節省開設模治具的成本與時間上的縮短，並求品質穩定性及量化需求，改善生產製程、優化生產效率、降低對人力需求及營運成本，以提升本公司之競爭力。
- (3)自動化製程：針對軟板生產多處需使用大量人力生產製程，將投入開發自動化設備以力求品質穩定性及量化需求，增購自動化及測試設備、改善生產製程、降低對人力需求及營運成本，以提升本公司之競爭力。
- (4)製程及材料專利佈局：持續在消費性軟板領用佈局材料及製程結構專利，以在競爭的市場上保有競爭優勢，以提升本公司之競爭力。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

本公司係專業軟式印刷電路板製造廠商，其產品可分為單層板、雙層板及多層板，產品銷售地區如下：

單位：新台幣仟元；%

地區 \ 年度	113 年度		114 年度	
	銷售額	%	銷售額	%
台灣	438,631	22.31%	490,827	22.88%
中國	1,527,509	77.69%	1,654,202	77.12%
合計	1,966,140	100.00%	2,145,029	100.00%

2.市場占有率

本公司主要產品為軟性印刷電路板，依據市調機構 Prismark 最新資料，114 年全球 PCB 產值達約 852 億美元，114 年本公司營收淨額為新台幣 21.45 億元，佔比約 0.08%。

3.市場未來之供需狀況與成長性

(1)需求部分

主要下游應用的需求走勢各異，整體呈現多元成長格局。智慧型手機方面，經歷近兩年的市場低迷後，有望隨 AI 功能導入、新機外觀創新而迎來換機潮。分析指出，AI 手機概念（搭載先進 AI 處理器、生成式 AI 應用等）將提升單機 FPC 用量，且摺疊機逐漸普及，帶動高階耐折軟板需求，預計 113 年起高階手機每台軟板數量和價值量均會提高，對 FPC 總需求形成支撐。

汽車電子則是最被看好的中長期動能，全球電動車銷售持續成長，傳統燃油車也加速電子化，推動車用 FPC 需求穩步上升。特別是電池管理、毫米波雷達、車載顯示等模組對軟板依賴度高，預估車用領域將是 FPC 成長最快的市

場之一。電腦與伺服器領域，雖個人電腦需求疲弱，但 AI 伺服器和高速網路設備興起，帶來高階軟板應用機會（如伺服器內部高速連接板）。在穿戴設備方面，智慧手錶、無線耳機及 AR/VR 設備需求持續擴大，FPC 因具備輕量化、耐彎折與高集成度特性，成為設計核心。機器人領域，FPC 可應用於機械關節、視覺系統及無線通訊模組。無人機市場則隨著物流、農業及軍用需求成長，FPC 憑藉輕量化與耐震特性，提升無人機續航與性能。

根據 Grand View Researc 研究顯示，預計 114 年至 119 年全球軟性印刷電路板市場規模將以 13.7% 的複合年成長率成長。智慧封裝解決方案的出現，使 FPC 在高密度集成和小型化電子元件方面的應用有了新的突破。在各行業多種因素的推動下，軟性印刷電路板市場正迎來強勁的成長。

(2) 供給部分

為了因應未來數年需求的增長，全球 FPC 產業供給端呈現積極的產能擴充與技術升級趨勢。在區域布局方面，主要廠商紛紛於中國大陸以外尋求新的產能據點，尤其以東南亞為投資熱點。泰國和越南已吸引多家台、日、韓、中廠商進駐，廠商希望透過靠近客戶提高市場反應速度，以滿足美系客戶訂單以及當地汽車電子和智慧手機市場的需求。相對過去集中於中國大陸的產能分布，東南亞的布局將使全球 FPC 供給版圖趨於多元分散，美、日、歐則因地緣風險的考量，也開始推動 PCB/FPC 在本土的生產，但短期內產能增長仍以亞洲為主。

在技術投資層面，儘管 111-112 年景氣放緩，FPC 業者的資本支出並未縮減，持續投資高階製程設備，以提前佈局未來需求。特別是高階 FPC 產品如超細線路、多層板以及低損耗材料（如 LCP、MPI）的需求升溫，使廠商積極採購高階曝光機、精密對位設備、雷射鑽孔機及高頻測試儀器等，以提升生產技術能力，因應折疊手機、5G 設備、車用雷達等產品所帶來的高規格需求。

整體來看，FPC 產業在 113 年起逐漸復甦，特別是技術門檻較高的車用與高速傳輸領域，價格與利潤較為穩健；相反地，標準化程度較高的低階消費產品則可能受到中國廠商產能擴張的價格壓力影響。

4. 競爭利基

(1) 經營團隊實力堅強

本公司投入軟性印刷電路板之製造與行銷逾三十年，經營團隊在印刷電路板產業領域中不論是行銷、製造或是管理方面均累積了豐富且寶貴的經驗，其中更不乏此行業中製造與研發經驗豐富之人員，引領技術團隊往更高階的產品技術發展，不僅將原有產品製程持續改良，積極推動自動化及製程合理化，提昇產品良率外，更對公司之經營管理投注心力，並致力於產品研發與技術提昇，為本公司未來面臨同業競爭時增添許多優勢。

(2) 客戶合作關係穩固

目前本公司之主要銷售對象多為知名大廠，雙方皆維持穩定之業務關係公司，接單政策係考量到客戶與產品組合，以求達到規模經濟生產及追求獲利，因而訂單穩定。

(3) 新產品之研發能力佳

公司為符合未來電子產品輕薄短小之趨勢，陸續開發出超細線路、多層軟板、元宇宙相關軟板及 5G 高頻高速相關軟板、醫療健康相關軟板，並開發出獨特產品或賦予產品新價值，具備新產品研發能力外，本公司之技術研發能力亦獲得世界知名大廠之認可，現更積極開發新產品，研發能力深受肯定。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

A.產品應用廣泛，產業發展遠景佳

產品應用廣泛，產業發展遠景佳。近年來，隨著電子產品朝多功能、輕薄方向提昇，使得軟板的技術與應用有更多成長的空間，涵蓋電腦、通訊、汽車及消費性電子產品。113 年~117 年電子產品主要成長力道為 AI、伺服器(邊緣運算、雲端相關運用)、物聯網(IOTs)、新能源電動車、智能穿戴裝置、元宇宙等相關領域產品應用。

B.產業供應鏈體系完整

下游電子產業持續發展的帶動下，加上上游原料之銅箔基板、覆蓋膜均可由國內多家廠商自行生產及加工廠商等支援，產業體系堪稱完整，而本公司原料以銅箔、保護膜及電子零件為主，與主要供應商長期以來皆維持良好之合作關係，貨源穩定。

(2)不利因素與因應對策

A.行業具污染性，環保意識高漲

軟式印刷電路板生產過程中，產生之廢水及廢棄物等，須有效處理及管理，近年來國內環保意識高漲與淨零排放趨勢，相關之環保法令日益嚴格，為強化防治污染作業減少碳排，公司治理採行 ESG(環境、社會、公司治理)策略，需增加環保及節能設備之投資及定期維護以因應環保需求。

因應對策：

- I.本公司從源頭減量、製程改善、末端控制及循環經濟四大面向著手推進。
- II.經第一次處理後之廢水符合水質標準納管放流至工業區之廢水處理廠做二次處理，雙重淨化水中污染物，以符合廢水排放標準；廢棄物處理方面以委託環保署合約之處理廠商代為處理。
- III.為加強防治污染工作，本公司除編列合格專業污染防治人員，隨時監控工廠各項排放標準，近年來更不斷增添環保設備，除符合環保法規之規定外，亦響應全球共同關切之環保意識。

B.人工成本逐年提高

軟板本身製程較為繁複，需使用許多精密先進設備及技術，對人才需求相對較高。此外產品規格日益精細下，在良率提升、產品品質控管考量上，仍有一定程度之人工需求。在國內勞工人才短缺，工資成本逐年提升下，需對人力資源政策作不斷的調整。

因應對策：

- I.增購自動化及半自動測試設備、改進生產製程，減少部分製程對於人力之依賴。
- II.透過合法管道引進外籍員工，並進行長期專業培訓，解決國內勞工人才短缺的問題。

C.下游產業競爭日趨激烈

近年來由於電子產品競爭激烈且毛利受到壓縮，下游電子廠商紛紛向上游供應商要求降價，使得軟板業者面臨產品品質及價格之競爭。

因應對策：

- I.持續改善本公司之生產製程與品質、研發生產新製程、提昇自動化設備及技術、e 化生產管理系統以縮短交期，及與客戶進行協同設計以縮短產品

開發期和提高產品良率，迅速支援產品組合變化，積極鞏固現有客源並開發潛在客戶，拉大與同業間的技術差異，以爭取新市場。

II.積極開發高附加價值之軟式印刷電路板，在市場區隔以確保本公司之競爭優勢，提高獲利空間，避免產品惡性競爭。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

軟性印刷電路板(FPC)是一種可撓式銅箔基板及絕緣性樹脂互相結合之複合產品，其以黃光、微影等圖形化線路方式，在可撓性基材上作線路佈置，作為電子產品訊號傳輸媒介，為承載電子零組件及連接零組件間電路之基礎元件，具傳統電纜線路、PCB 印刷電路、及可同時連接多種不同部位件等多功能整合系統之功能。由於具有可連續自動化生產、提高配線密度、重量輕、體積小、減少配線錯誤、可撓性及可彈性改變形狀等特性，廣泛應用於消費性電子產品。該產品主要應用於筆記型電腦、智慧手機、平板、E-book、數位相機、工控產品、TV、穿戴裝置、智慧居家、醫療檢康與健身等相關產品、車用電子、元宇宙、高速/高頻、無人機等先進的民生產品領域和電腦週邊設備。

2.主要產品之產製過程

(1)目前同泰軟板捲對捲基礎製造流程如圖 2：

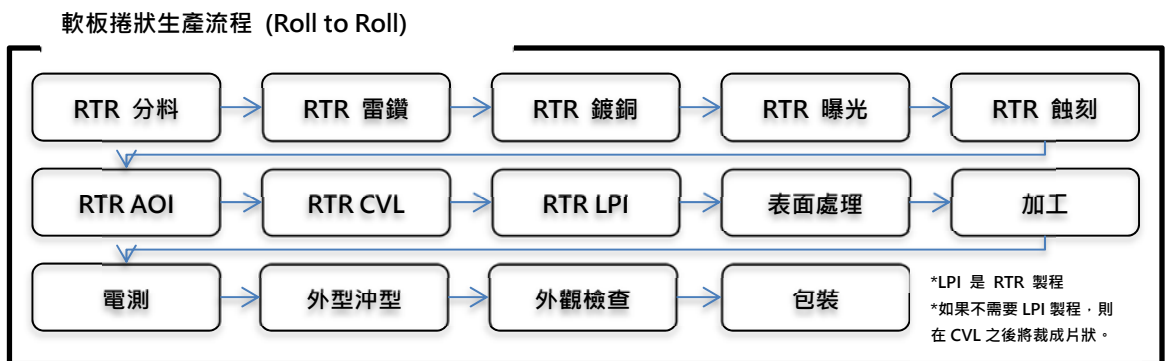


圖 2 軟板捲對捲基礎製造流程

(2)目前同泰軟板片式製造流程如圖 3：

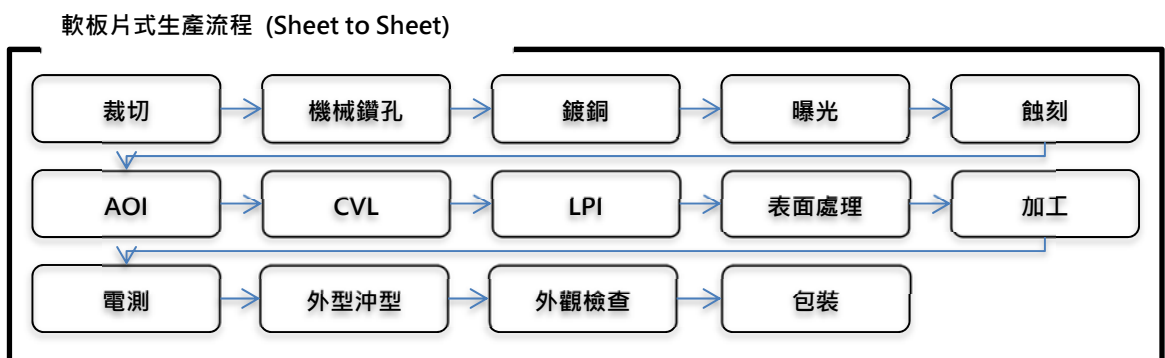


圖 3 軟板片式基礎製造流程

(3)目前同泰 SMT 基礎製造流程如圖 4：

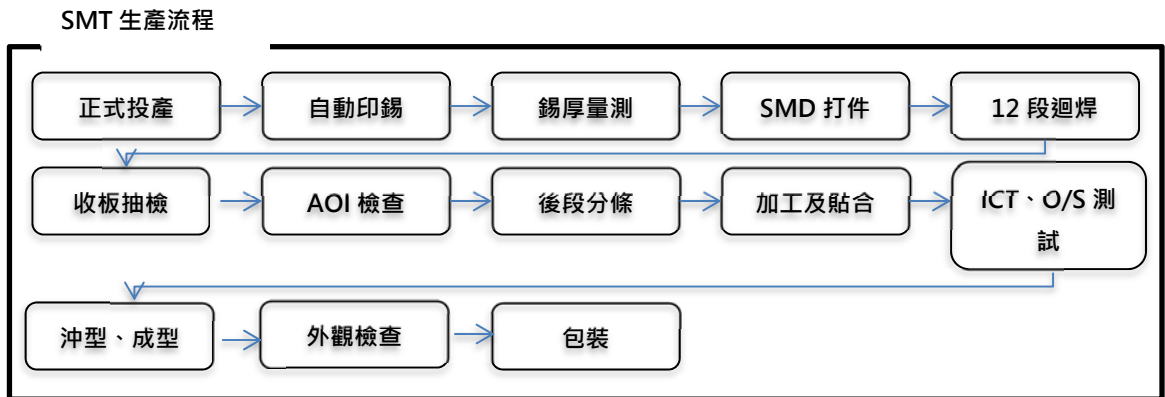


圖 4 SMT 基礎製造流程

(三)主要原料之供應狀況

本公司主要原料為 FCCL、覆蓋膜、金鹽及電子元件等，目前除主要往來供應商外，尚保持其它相同供應商二家以上之聯繫，以確保供貨來源之穩定。

(四)主要進銷貨客戶名單

1.主要進貨供應商名單

最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之廠商名單：

以集團而言，最近二年度任一年度及截至 115 年第 1 季中尚未有任一家供應商占進貨總額百分之十以上。

2.主要銷貨客戶名單

最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名單：

單位：新台幣仟元

項目	113 年度				114 年度				115 年度截至第一季止			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	客戶 A	547,886	27.87%	無	客戶 A	652,259	30.41%	無	客戶丁	126,417	28.67%	無
2	客戶丁	577,503	29.37%	無	客戶丁	354,474	16.53%	無	客戶戊	51,939	11.78%	無
3	客戶 F	26,274	1.34%	無	客戶 D	81,801	3.81%	無	客戶 F	47,626	10.80%	無
	其他	814,477	41.42%	-	其他	1,056,495	49.25%	-	其他	214,923	48.75%	-
	銷貨淨額	1,966,140	100.00%	-	銷貨淨額	2,145,029	100.00%	-	銷貨淨額	440,905	100.00%	-

增減變動原因：近 2 年主要客戶並無重大變化。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率：

單位：人

年度		113 年度	114 年度	115 年 4 月 27 日
員工人數	直接人員	1,006	950	908
	間接人員	377	348	334
	合計	1,383	1,298	1,242
平均年歲		35.03	35.58	35.64
平均服務年資		5.08	6.21	6.44
學歷分布比率(%)	碩士	5.52%	0.77%	0.48%
	大專	25.96%	35.75%	34.62%
	高中	37.10%	39.75%	38.65%
	高中以下	31.42%	23.73%	26.25%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

五、勞資關係

(一)各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1.員工福利措施

(1)本公司員工除享有勞保、健保、退休金給付等一般福利外，公司另有提供之福利：年終獎金、核心關鍵人才獎金、五一勞動節禮金、生日禮金、端午節禮金、中秋節禮金、績效獎金、激勵獎金、紅利獎金、提案改善獎金、員工

團保、員工宿舍、員工定期健康檢查、衛教服務、員工婚喪補助、員工住院慰問、生育補助、模範員工選拔以及提供員工在職進修補助和教育訓練講習等各項福利措施。

(2)本公司於87年6月14日依法成立職工福利委員會，並依法向台中市政府登記(87府勞福字第13736號)，福利委員並由各部門依比例推舉組成，定期召開會議與改選福利委員，福利委員會每年皆訂定年度計畫，規劃辦理員工福利包括：年節贈送禮品或禮金、急難救助、社團活動、各項競賽活動、簽訂特約商店優惠等各項活動。

2.員工進修、訓練

為配合本公司之發展目標，使全體從業人員藉由教育訓練得以充實品質、有害物質、環安衛意識、技能、知識，在安全舒適的工作環境下提高工作品質、效率、推動環安衛、有害物質管理系統之維護，達到品質、無有害物質、環安衛目標和符合客戶環境管理物質的要求，強化企業經營體質，滿足客戶需求，增加在市場上的競爭優勢。

3.退休制度與實施情形

本公司依勞動基準法規定，實施勞退舊制，公司按月提撥薪資總額2%提撥退休金並專戶存儲於台灣銀行。

本公司依勞工退休金條例規定，施行勞退新制，公司按月提撥勞工退休金（不低於薪資6%）於員工個人退休金帳戶。

子公司同揚光電(江蘇)有限公司業已按中華人民共和國政府規定之養老保險制度，每月依當地員工薪資總額之一定比率提撥養老保險金。

4.勞資間之協議

勞資關係之協調一直是本公司努力的重點。本公司舉凡政策之宣導、員工的意見了解皆採開放雙向溝通方式進行，以使勞資雙方關係維持和諧。

5.員工權益維護措施情形

本公司除依法成立職工福利委員會，統籌辦理職工福利金之籌畫、提撥、保管、動用及相關法令所規範之相關事宜外，作為勞方與公司間溝通的橋樑，對於員工各項權益的維護及福利制度的執行，皆以法令規範為依據。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

六、資通安全管理：

(一)資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源。

1.資通安全風險管理架構:

本公司雖尚未成立資通安全管理部門，惟已強化資訊安全管理，確保所屬資訊之機密性及完整性，並不定期進行資訊安全檢查。

2.資訊安全政策:

- (1)重要資訊系統或設備已建置適當備份、備援或監控機制，以維持其可用性。
- (2)個人電腦均安裝防毒軟體且定期更新病毒碼之更新，並禁止使用未經授權的軟體。

3.具體管理方案及投入資通安全管理之資源:

- (1)網路及電腦系統安全管理。
- (2)設置文件管理系統，重要資料皆上傳於系統中，並設定存取權限。

(3)設置防火牆，定期備份設定檔，並定期維護網路設備及伺服器。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司尚無因重大資通安全事件所遭受損失情事。

七、重要契約

115 年 4 月 27 日

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
長期借款	上海銀行	110/8/11-122/8/11	土地及廠房抵押借款	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	114 年度	差異	
			金額	%
流動資產	1,410,743	1,649,730	238,987	16.94%
不動產、廠房及設備	404,711	380,286	(24,425)	(6.04%)
無形資產	1,267	469	(798)	(62.98%)
其他資產	56,679	109,211	52,532	92.68%
資產總額	1,873,400	2,139,696	266,296	14.21%
流動負債	1,105,334	1,158,191	52,857	4.78%
長期負債	300,833	220,392	(80,441)	(26.74%)
其他負債	1,432	43,185	41,753	2915.71%
負債總計	1,407,599	1,421,768	14,169	1.01%
股本	971,598	861,138	(110,460)	(11.37%)
資本公積	395	99,265	98,870	25030.38%
保留盈餘	(440,461)	(180,133)	260,328	59.10%
股東權益其他調整項目	(65,731)	(62,342)	3,389	5.16%
股東權益總額	465,801	717,928	252,127	54.13%
重要變動項目(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者)之主要原因及其影響分析如下：				
1. 其他資產增加：主係使用權資產及預付設備款增加之影響。				
2. 長期負債減少：主係 114 年現金增資償還長期借款之影響。				
3. 其他負債增加：主係租賃負債-非流動增加之影響。				
4. 資本公積增加：主係 114 年現金增資之影響。				
5. 保留盈餘增加：主係 114 年現金增資及當年度損益影響。				
6. 股東權益增加：主係 114 年現金增資及當年度損益之綜合影響。				

二、財務績效

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	114 年度	增減金額	變動比例(%)
營業收入	1,966,140	2,145,029	178,889	9.10%
營業成本	1,921,231	2,014,097	92,866	4.83%
營業毛利	44,909	130,932	86,023	191.55%
營業費用	278,865	276,781	(2,084)	(0.75%)
營業淨損益	(233,956)	(145,849)	88,107	37.66%
營業外收入及支出	31,152	(26,349)	(57,501)	(184.58%)
稅前淨損	(202,804)	(172,198)	30,606	15.09%
所得稅費用	(5,678)	(7,934)	(2,256)	(39.73%)
合併總損益	(208,482)	(180,132)	28,350	13.60%
重要變動項目(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者)之主要原因及其影響分析如下：				
1. 營業毛利增加：主係營業收入上升及成本變動相關影響所致。				
2. 營業淨損減少：主係營業收入上升及成本變動相關影響所致。				
3. 營業外收入及支出減少：主係美金升值，兌換損失增加及利息支出增加之影響。				

(二)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

全面深耕自動化、無人化、標準化，藉此全面提升生產效率、減少人員操作失誤機會、文件標準化，並進行滾動式的內部調整機制，如產品結構、組織架構及分散客戶等，並大力發展多元化產品，如車用照明、元宇宙相關產品、新能源電動車相關軟板、5G 應用及醫療健康相關軟板等，而整個輸出方面則主要係依據總體經濟環境變化、產業動向及公司未來之發展方向，並參酌公司近期營運概況所擬定之營運目標。

三、現金流量

(一)最近年度(114 年)現金流量變動之分析說明

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額 a	全年來自營運 活動淨現金流 出量 b	全年現金 流入量 c	現金剩餘(不 足)數額 a-b+c	預計現金不足額之 補救措施	
				投資計畫	理財計畫
220,722	250,868	245,006	214,860	-	-
(1)最近年度現金流量重大變動原因如下：					
營業活動：主因營業損失，產生淨現金流出。					
投資活動：主因取得營業設備產生淨現金流出。					
籌資活動：主因現金增資產生淨現金流入。					
(2)現金不足之補救措施：不適用。					

(二)流動性不足之改善計畫：無流動性不足之疑慮。

(三)未來一年(115 年)現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額 a	預計全年來自 營運活動淨現 金流入量 b	預計全年現金 流出量 c	預計現金剩 餘(不足)數 額 a+b-c	預計現金不足額之 補救措施	
				投資計畫	理財計畫
214,860	110,741	211,110	114,491	-	-

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

單位：新台幣仟元

轉投資事業	投資政策	主要營業項目	114 年認列之投資損益	獲利或虧損原因	改善計畫	未來一年投資計畫
Uniflex Investment Limited	轉投資大陸江蘇之子公司	控股公司	794	為控股公司，認列權益法投資損益所致。	無。	無
同揚光電(江蘇)有限公司	軟式印刷電路板之生產銷售	FPC	1,016	主係公司持續深耕客戶開發，訂單有效發酵下，致 114 年營業收入成長及有效推行成本管控。	無。	無
Uniflex Group Limited	轉投資大陸江蘇之子公司	控股公司	-	無。	無。	無

六、風險事項之分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1.利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114 年度
利息費用	26,926
營業收入淨額	2,145,029
利息費用佔營業收入淨額比例	1.26%

資料來源：經會計師查核簽證之 114 年度財務報告

本公司 114 年度利息費用佔營業收入總額之比率約為 1.26%，故短期而言利率變動對本公司之損益表現影響不大。而本公司之因應利率變動之措施，係基於穩健務實之財務管理基礎下，將維持良好財務結構及償債能力，作為對金融機構議價及談判的有利籌碼，並與各銀行密切聯繫已取得較優惠的借款利率，並視利率條件適時調整短、中、長期融資額度，以降低利率變動對本公司財務之影響。

2.匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114 年度
淨外幣兌換利益	(15,935)
營業收入淨額	2,145,029
兌換利益佔營業收入淨額比例	(0.74%)

資料來源：經會計師查核簽證之 114 年度財務報告

本公司 114 年度淨外幣兌換損失佔營業收入總額之比率為 0.74%，主係因國際短期匯率變動，對本公司之損益表現並無重大影響。而本公司主要之進銷貨係以美金為計價單位，公平市價將隨市場匯率波動而改變，故國際美元走勢與本公司匯兌損益息息相關。為規避匯率變動對本公司獲利的潛在影響，本公司藉由外幣資產與負債相抵，利用自然避險方式，降低匯率曝險部位，將外幣淨部位維持在可控制範圍，降低匯率風險，若然匯率波動大且變化快速，則避險之效益可能

會因而降低。本公司將持續監控匯率變化，採取適當措施，以降低匯率波動對公司損益所帶來之影響。

3.通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施

本公司之上游原物料受通貨膨脹影響甚小，惟國際銅價和通貨膨脹高度關聯，本公司主要原料銅箔和基板恐因國際銅價變動影響報價，然業界對於銅箔之採購有明確的定價模式可循，電解銅箔市場上之售價亦採業界慣例而訂，且本公司與供應商長期維持良好關係，評估通貨膨脹對本公司損益影響甚微。為規避潛在價格變動風險，本公司隨時觀察原物料市場價格波動，並持續與供應商保持良好互動關係，因應成本變動調整進貨政策，降低通貨膨脹對本公司造成之影響。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

1.從事高風險、高槓桿投資之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司專注本業發展，基於穩健原則，最近年度及截至年報刊印日止並未從事高風險及高槓桿投資等交易情事。

2.從事資金貸與他人、背書保證之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司依主管機關相關法令及規定，訂定內部管理及作業程序，包括「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，以為管理並控管相關交易風險，截至114年12月31日止，本公司未有背書保證之情事，另為因應本公司營運資金需求，子公司Investment擬資金貸與本公司美金75,333.65元額度內，貸與期限以董事會決議日起算一年之期間內分次撥貸或循環動用，對本公司及其各子公司之財務業務應無不利之影響。截至年報刊印日止，本公司並無因從事背書保證或資金貸與而產生虧損之情事。

3.從事衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無從事衍生性商品交易。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司未來一年仍將致力投入生產製程之改善，投入測試儀器及自動化製程之研發等，預估115年度投入研發支出約新台幣8,000萬元。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司將隨時注意各國政府對本公司所屬產業推行之重要政策及法令規定，採取適當經營策略，同時開發符合產業之新技術及產品，以擴展市場版圖。此外，本公司日常營運均遵照國內外相關法令規定辦理，並隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法規變動情形，蒐集相關資訊提供經營階層決策參考，以充分掌握經營環境變化，適時調整本公司營運策略。最近年度及截至年報刊印日止，本公司並未受國內外重要政策及法律變動而有影響公司財務業務之情事。

(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

由於近年來科技進步，軟性印刷電路板之電子產品持續增加，本公司已於臺灣台中及中國大陸設廠，冀望擴展市場版圖。本公司隨時注意所屬產業相關之科技改變及技術發展，評估對本公司營運之影響並作相對應之調整。此外，本公司亦積極開發符合未來市場需求之技術及服務，且隨時密切注意相關行業的科技變化，及資通安全相關風險情勢發展，以確保本公司之市場競爭力，強化本公司業務發展及財務狀況，惟近年尚無重大科技改變或產業變化而對本公司財務業務有重大影響之情事。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司經營團隊一向秉持專業及誠信經營原則，多年來致力維持企業形象與風險控管，本公司最近年度及截至年報刊印日止，尚未有因企業形象改變而造成公司

營運危機之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有進行併購計畫，惟將來若有進行併購計畫時，將依本公司「取得或處分資產作業程序」，秉持審慎評估態度，考量合併是否能為公司帶來具體綜效，以確實保障股東權益。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1.進貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司主要進貨項目為軟性銅箔基板、保護膜等相關軟板製造所需上游材料，其中 114 年度前三大進貨廠商佔進貨總額分別為 9.55%、7.64%及 5.73%。本公司向前三大進貨廠商進貨之主要品項為 IC、銅箔基板、保護膠片、貴金屬及各式電子零組件等，由於主要進貨廠商佔比不高，且國內外主要原料之供應者眾多，進貨品項尚無高度依賴某供應商之情形，尚無進貨集中之風險。

2.銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司 114 年度前三大銷貨客戶之銷貨金額佔銷貨總額比重分別為 30.41%、16.53%及 9.17%，銷售軟板品項之終端運用多元，無特定集中運用之情形，尚無明顯銷貨集中之情形。

(十)董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

(一)關係企業合併營業報告書：

請參閱公開資訊觀測站網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

(二)關係企業合併財務報表：

請參閱公開資訊觀測站網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

(三)關係報告書：

請參閱公開資訊觀測站網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。